中信证券股份有限公司

关于重庆宇隆光电科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年八月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”或“本保荐人”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的简称与招股说明书中的简称具有相同含义。

目 录

声 明.....1

目 录.....2

第一节 发行人基本情况.....3

一、发行人基本情况.....3

二、发行人主营业务情况.....3

三、主要经营和财务数据及财务指标.....16

四、发行人存在的主要风险.....17

第二节 本次证券发行基本情况.....29

一、本次发行情况.....29

二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况.....29

三、保荐人与发行人的关联关系.....30

四、保荐人内部审核程序和内核意见.....31

第三节 保荐人承诺事项.....33

第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见.....34

一、推荐意见.....34

二、发行人本次证券发行履行的决策程序.....34

三、发行人符合创业板定位要求.....35

四、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件.....51

第五节 上市后持续督导工作安排.....57

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称：重庆宇隆光电科技股份有限公司

英文名称：Chongqing E-ong Optoelectronics Technology Co., Ltd.

统一社会信用代码：91500000092411201U

注册资本：38,730.2537 万元

法定代表人：王亚龙

有限公司成立日期：2014 年 3 月 6 日

整体变更为股份公司日期：2021 年 1 月 29 日

注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 72 号

邮政编码：400714

联系电话：023-63170080

传真号码：023-67285503

互联网网址：http://www.e-ong.com.cn

电子信箱：ir@e-ong.com.cn

二、发行人主营业务情况

（一）主营业务概况

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，致力于成为我国智能控制领域最有价值的企业。

报告期内，公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品，终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。

自设立以来，公司始终以新型半导体显示面板为核心应用领域，深耕 LCD

显示面板专用智能控制卡及精密功能器件产品，并快速拓展 OLED、Mini/Micro LED 等显示领域新技术的应用发展，掌握了以显示用智能控制卡、显示用精密功能器件为核心产品的技术研发、生产制造等相关的专利技术和先进生产工艺，全面覆盖目前主流及未来新型显示技术路线。目前，公司已拥有样品、中小批量、大批量等各级产品综合制造能力，通过开展 DFM 可制造性分析及 BOM 优化、PCB Layout 模拟仿真、高精度电子装联、关键功能器件制造、终端级检测、售后服务等全套业务流程，长期服务于我国具有国际竞争力、先进制造工艺的半导体显示面板领先厂商。

凭借丰富的制造服务经验、优异的技术工艺及产品品质、完善的配套服务体系、高效的新产品响应速度以及业内一流的规模化量产交付能力，公司自成立以来助力我国半导体显示面板产业国产化率不断提升，持续开拓优质客户资源，获得了业内的广泛认可。作为最早进入京东方供应体系的显示用智能控制卡内资制造商，公司于 2014 年打破外资厂商对显示用智能控制卡业务的垄断，现已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商上述业务的主要供应商。

与此同时，公司以成为我国智能控制领域最有价值的企业为目标，积极拓宽业务边界、持续开拓产品应用领域，与国家关键战略新兴产业同频共振，不断实现自身业务布局及产品结构的突破和发展。在新产品方面，公司已在 Mini/Micro LED 等新型显示领域进入样品开发阶段；与此同时，公司已积极布局汽车电子等领域，并实现了对比亚迪、赛力斯等厂商的合格供应商认证和批量供货。2025 年下半年，公司与韩国上市公司纽禄美卡共同成立合资公司，以实现“AI 时代”的全新战略布局为目标，拟在现有业务基础上进一步拓展协作机器人领域。

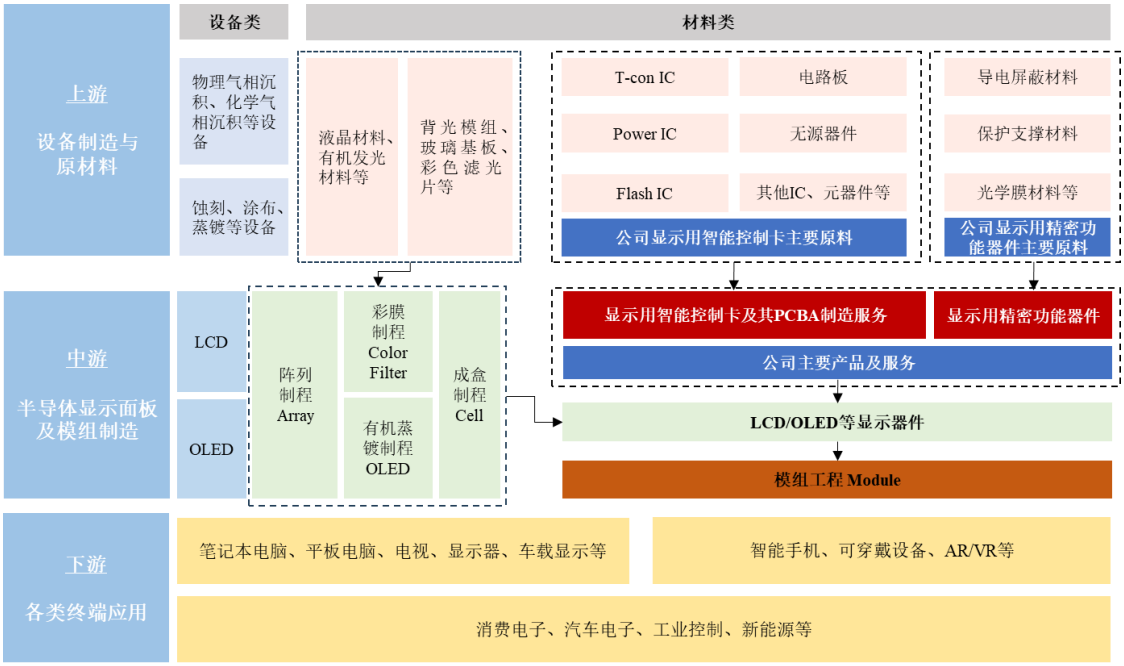
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有专利权 306 项，其中包括 12 项发明专利，另有 46 项发明专利正在申请中，参与了 3 项国家标准的起草制定。公司始终将研发投入和技术创新作为企业发展的核心驱动力，设立了显示研发实验中心和可靠性测试平台，并与多所知名高校共建联合实验室，汇聚光学、电子、软件等多学科人才。

经过多年发展创新及技术积淀，公司的生产经营规模、工艺装备水平、产品

研发能力、质量控制以及产品交付能力等均处在行业领先水平，被评为国家重点支持专精特新“小巨人”企业、国家智能制造优秀场景、国家级高新技术企业、重庆市“高精度 PCBA 控制板制造数字化车间”、重庆市“高精密 OLED 控制板生产数字化车间”、重庆市知识产权优势企业、中国潜在独角兽企业等，并获得重庆市企业技术中心、重庆市制造业中试平台等资质认定。

（二）公司主要产品及服务

公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品。上述产品在半导体显示面板产业链中的应用及所处位置示意如下：



注：模组工程（Module）对于LCD或OLED显示面板存在一定差异。其中，LCD面板生产过程中，模组工程主要包括：切割、磨边、液晶盒进行偏贴、芯片（IC）绑定、涂胶、PCB板绑定、背光组装等工序，最终形成LCD显示模组；OLED面板生产过程中，模组工序主要系先将面板根据不同产品型号进行切割，并经面板测试、偏光片贴附、芯片（IC）绑定、柔性印刷电路板（FPC）绑定、盖板贴合等工艺流程形成全模组产品。

1、显示用智能控制卡业务

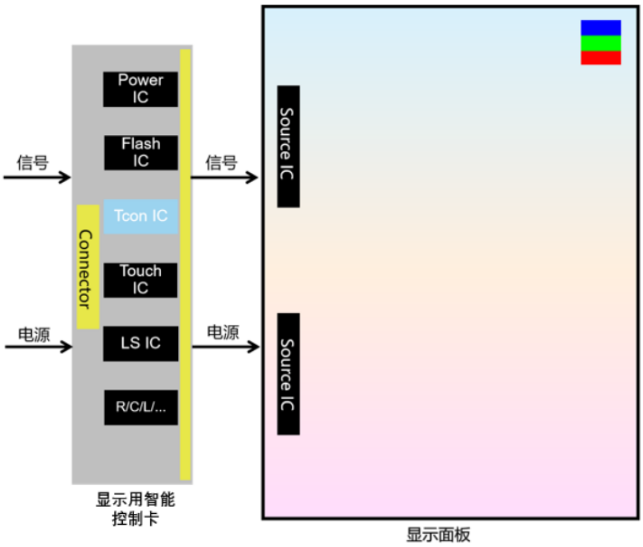
报告期内，公司通过自主采购原料生产显示用智能控制卡产品或向客户提供显示用智能控制卡 PCBA 制造服务。

（1）显示用智能控制卡产品

公司显示用智能控制卡产品主要应用于新型半导体显示领域，是显示面板系统中的关键核心部件。产品能够实现高带宽视频信号解码与格式转换、精密行列扫描时序规划，并对 Gamma、色域、均匀性、寿命等多维度显示驱动算法进行

综合管理，从而确保显示画面稳定、准确呈现，有效提升面板整体性能与运行可靠性，也被称为半导体显示面板的“大脑”。

显示用智能控制卡的基础结构及工作原理



注：（1）T-con IC：时序控制芯片；（2）Power IC：电源管理芯片；（3）Flash IC：闪存芯片；（4）Touch IC：触控芯片；（5）LS IC：电平转换芯片；（6）R/C/L/...：电阻、电容、电感等电子元器件。

如上图所示，显示用智能控制卡以 PCB/FPC 基板为基础，集成了 T-con IC 芯片模块、Power IC 芯片模块、L/S IC 芯片模块等 IC 芯片模块，具备了时序控制、电压转换、图像算法优化、信号转换等功能，从而能够将图形图像数据信号转换成显示屏所需的行列驱动信号，实现对屏幕画面显示的控制和算法优化，最终呈现出最优的画面显示给终端用户。随着终端电子产品智能化、轻薄化趋势加剧，基板层数不断增加，元器件体积持续缩小，显示用智能控制卡亦朝着高精度、高密度、高集成度方向持续发展。

显示用智能控制卡通常用于需要独立控制电路的中大尺寸显示面板，终端应用于平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视以及车载屏幕等领域。该等显示面板尺寸较大、分辨率较高，通常需要独立的控制卡以实现时序驱动、信号转换、图像处理等功能；而终端应用于手机、智能穿戴等领域的小尺寸显示面板，其尺寸较小、集成度要求高，因而显示控制功能大多直接集成于主处理器（SoC）或显示驱动芯片之中，不外置独立的“控制卡”。

报告期内，公司显示用智能控制卡产品及其终端主要应用情况如下：

产品名称	产品应用	产品图例	终端应用图例
显示用智能控制卡	平板电脑		
	笔记本电脑		
	显示器		
	中大尺寸电视		
	新能源汽车智能座舱显示屏		

（2）显示用智能控制卡 PCBA 制造服务

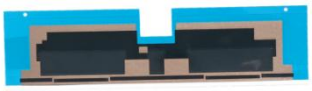
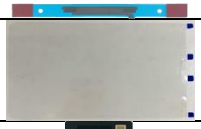
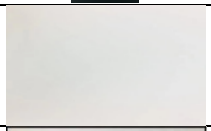
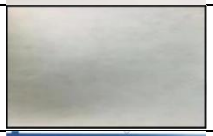
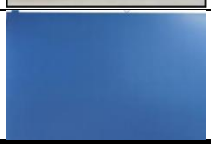
除自主采购物料用于生产制造向客户实现销售外，公司亦通过开展 PCBA 制造服务向客户提供显示用智能控制卡产品。报告期内，公司 PCBA 电子制造服务流程包括产品设计评估、产品开发、样件试制、性能检测、售后服务等流程。具体过程如下：

序号	流程名称	具体内容
1	产品设计评估	产品开发过程中整合设计需求与制造可行性的系统化方法，通过优化电路设计与制造系统的相互作用，降低开发周期
2	产品开发	对产品进行开发，开发活动包含设计开发、DFM 可制造性分析、测试环境开发、试制辅助治工具及各工序程式开发、物流包装设计等
3	样件试制	根据设定的 PCB Layout 组件布局图，将 PCB、IC、电阻电容、连接器等材料进行装联和电气连通的制造过程
4	性能检测	对经过装联后的产品进行多维度检测，具体包括可靠性测试、环境适应性测试、电性测试、功能测试、芯片读写与校验、画面检测等
5	售后服务	提供远程与现场技术支持，产品维修、更换和质保期内免费保障等

2、显示用精密功能器件

公司的显示用精密功能器件产品主要应用于消费电子领域，是平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子产品内部半导体显示面板结构中实现特定功能的器件，具体可以分为功能类器件和光学类器件。其中，功能类器件具备单一或者多种功能，包括但不限于电磁屏蔽、散热导热、水氧阻隔、导电、绝缘、缓冲、填充等功能；光学类器件可实现对显示光源光线的反射、扩散、增强汇聚等功能。

公司主要显示用精密功能器件产品及其终端主要应用情况如下：

序号	产品分类	产品类型	产品图例	终端应用图例
1	功能类器件	导电类功能器件		
		绝缘屏蔽类功能器件		
		缓冲补强类功能器件		
		保护类功能器件		
		复合类功能器件		
2	光学类器件	反射类光学器件		
		扩散类光学器件		
		增光类光学器件		

（三）公司主要产品市场地位

公司主要产品广泛应用于国内龙头半导体显示面板厂商，最终在全球知名终端品牌商消费电子产品中广泛应用。

序号	主要产品名称	主要客户及其下游终端品牌	
		公司主要客户	主要客户下游终端品牌
1	显示用智能控制卡	京东方、和辉光电、深天马、广州国显、华星光电、惠科股份	苹果、华为、荣耀、联想、戴尔、惠普、华硕、小米等国内外知名品牌
2	显示用精密功能器件		

截至目前，公司主要产品显示用智能控制卡已取得一定的市场地位。根据 Frost & Sullivan 数据，2024 年公司在中国显示用智能控制卡主要应用领域（包括笔记本电脑、平板电脑、显示器、电视和车载屏幕）的市场份额约为 14%，市场排名第一，已处于行业领先地位。

（四）公司核心技术情况

截至本上市保荐书签署日，公司核心技术情况如下：

核心技术	技术名称	应用领域	使用效果、技术先进性及具体表征	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	专利对应情况
显示用智能控制卡设计及性能优化	显示效果优化技术	显示用智能控制卡	针对不同温度环境液晶偏转角不一致导致的显示效果差异，通过在显示面板上的多组温度传感器实时反馈显示面板温度数据，搭配显示控制板上的自研补偿电路，能根据面板温度变化实时调整液晶分子的偏转电压，改善了液晶偏转角均一性不佳的问题，保证了显示模组在不同温度环境下显示效果的一致性	自主研发	前段工艺-产品设计及可制造性设计	应用阶段，应用于主营业务产品	2022231919309 一种液晶显示设备的温度补偿电路 2022117242356 一种显示效果的调整方法、装置、设备、介质及显示器
	背光亮度均一性补偿技术	显示用智能控制卡	针对传统显示面板背光调光技术对显示效果均一性的负面影响，通过建立了背光控制信号系统和液晶分子偏转角控制系统的双系统实时耦合关系，建立了背光 PWM 信号与液晶分子偏转电路中 TFT 栅压的微秒级反馈链路，实现了背光控制和液晶分子偏转角的联动动态补偿控制，使得显示面板在背光亮度变化的情况下保持了画面显示效果一致	自主研发	前段工艺-产品设计及可制造性设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	DFM 可制造性设计及模拟仿真应用技术	显示用智能控制卡	通过开发软件的建模算法对标准 Gerber 文件进行转换建模，形成 3D 虚拟产品的模型，实现了在设计阶段就对产品的 3D 整体模型进行观察和自动匹配规则库进行检查，达到了在资料设计阶段就提前检查出电子器件和 PCBLayout 设计缺陷问题，有效缩短新产品开发周期	自主研发	前段工艺-产品设计及可制造性设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
显示用智能控制卡精密制造技术	软硬板高精密连接技术	显示用智能控制卡	一方面，通过对产品的焊点仿形设计钛合金压头，达到高导热和降低热效率损失的效果，实现了精准的焊接温度控制的效果。另一方面，通过在设备中整合视觉检测装置，在软板和硬板的对位时实现精准的视觉定位，实现了对位偏差±0.1mm 的精度，完成高密度小间距的刚性板与柔性板信号线路的垂直连接	自主研发	后段工艺-Hotbar	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	高精度 SMT 定位装联技术	显示用智能控制卡	该技术通过自主设计的高精度合金治具对 PCB 进行精准定位，通过搭配纳米钢网，可以实现 0.2mm 小间距及 0.25*0.125mm 封装器件的贴装焊接，从而提升焊接良率，提高器件的贴装密度和集成度	自主研发	前段工艺-贴片	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	精密视觉与算法技术	显示用智能控制卡	该技术优化了 AOI 设备的多角度光学检测技术：通过增加彩色成像加侧视光源组合，识别元件偏移、立碑、焊球缺失等缺陷，尤其针对连接器等器件侧边隐藏焊点进行 3D 建模分析，增加设备的拦截率	自主研发	前段工艺-AOI 检测	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	Hotbar 高效自动组装技术	显示用智能控制卡	通过工艺设计和技术整合，达到了 Hotbar 流程从上料到下料的高效自动化生产技术需求：1、通过对 Hotbar 焊接工艺和生产流程的梳理，设计出完整的焊接线体。线	自主研发	后段工艺-Hotbar	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术

核心技术	技术名称	应用领域	使用效果、技术先进性及具体表征	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	专利对应情况
			体通过设计专用的多拼板焊接治具和整合自动点助焊剂的装置，实现自动定位点助焊剂，达到高效生产的目的，实现了 6 倍的点助焊剂效率提升；2、通过整合 Hotbar 焊接压头的设计，将 6 个压头进行设计合并，实现了多拼板同时生产的目的，实现了焊接效率提升 6 倍的效果；3、通过设计专用的下料装置，整合真空吸嘴和 Tray 盘上下料的自动定位和剥离机构，实现对生产后的自动吸附至 Tray 中，达到了自动化下料的目的				
	微米级 SMT 电子封装技术	显示用智能控制卡	一方面，通过 SMT 纳米钢网的优化及炉温的精准控制，使元器件焊点上的助焊剂充分挥发，减少助焊剂的阻隔，提升了胶水的毛细蔓延效果，实现了 UF 胶填充率由 90%提升至 100%的进步。另一方面，通过优化 UV 胶水的成分配比，同时配合调整点胶机的点胶路径，实现了将溢胶范围控制在 0.6mm 以内，使胶水的涂敷厚度＞25um。达到了防水等级 IPX8 级，实现 30 米生活防水	自主研发	后段工艺-底部填充点胶	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	高精度组合涂覆技术	显示用智能控制卡	通过对点胶设备改造雾化阀和电磁阀的合并，可以进行双阀同时作业，对于点胶精度要求高的区域使用电磁阀点胶，要求不高的全区域使用雾化阀点胶，实现了高精度的三防胶水点胶工艺的同时还保存着高效的点胶效率。达到了三防点胶 1.5mm 溢胶的高标准需求	自主研发	后段工艺-点三防漆	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
显示用智能控制卡检测技术	线路测试保护技术	显示用智能控制卡	通过研发用于芯片读写与测试过程的控制、隔离、保护电路及测试程序，大幅降低芯片的数据传输丢失率、信号的抗干扰性能及外源对芯片造成的浪涌损坏	自主研发	后段工艺-检验	应用阶段，应用于主营业务产品	2024209388933 一种 SPI 上传和下载的控制和辅助电路 2024212294734 一种 I2C 烧录读写的电平转换的隔离保护电路
	微米级、多维度采样检测技术	显示用智能控制卡	通过研发动静态结合测试技术、自容互容模拟检测技术、智压检测装置并结合高精度视觉技术和运控系统，替代行业传统的探针测试技术并实现自动化。从而将测试采样点的最小尺寸由毫米级降低至微米级，将传统的单一测试能力提升至多维度测试，同时大幅提升缺陷侦测率、测试直通率及测试稳定性	自主研发	后段工艺-检验	应用阶段，应用于主营业务产品	2024215074280 一种 FPCtoFPCA 假性压合测试工装 2021231536650 一种具有导向功能的 FPC 软板测试装置
	高自由度测试设备技术	显示用智能控制卡	采用自主研发融合飞针的静态测试系统、动态测试系统、并行测试技术，通过软件编程的高效测试路径，取代传统的固定针模的人工测试治具。实现无治具的通用型与自动化测试，并且该技术采用编程及算法，程序化	自主研发	后段工艺-检验	应用阶段，应用于主营业务产品	2024106987650 一种电路板的智能型无载测试装置、系统及其方法；

核心技术	技术名称	应用领域	使用效果、技术先进性及具体表征	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	专利对应情况
			并行测试待测品的性能参数，通过 SPEC 管控采样数据的准确性，筛选出瑕疵品，从而大幅提升测试效率、测试覆盖率				2020115301100 一种控制板卡专用检测台；2024206238243 一种嵌入式警示灯
	OLED 控制卡智能检测技术	显示用智能控制卡	通过研发集成多轴机械手臂控制系统、多功能视觉辅助系统和开发新型的产品载具快速换型装置，实现对各种显示用智能控制卡自动化测试及自动分拣。该技术下的全自动化测试实现“无人化”作业，数倍提升检测效率、提升 40%以上的测试覆盖率	自主研发	后段工艺-检验	应用阶段，应用于主营业务产品	2023226434105 一种产品载具快速换型装置 2024218204638 一种显示屏电路板的接触式测试设备 2020115496611 一种用于测试产品性能的自动化测试设备及系统
	自动化外观检测技术	显示用智能控制卡	通过研发优化 AOI 程序及开发金面检测算法与装置，用于高效、精密的检测控制卡的金面缺陷。该技术结合自动化装置，替代传统的裸眼检查，提升自动化水平、提高产品可靠性及良率，并保障产品出货质量稳定提升至国际标准最高等级 CLASS3，处于行业领先水平	自主研发	后段工艺-检验	应用阶段，应用于主营业务产品	201720527772X 一种电路板自动检测设备 2021222120538 一种 AOI 检测装置
精密功能器件开发、优化与治具设计技术	背光模组支撑体系优化技术	显示用精密功能器件	通过新材料组合 PSA（压敏胶）、PET 材质以及 Foam（泡棉）替代传统注塑支架，在保障性能基础上，简化生产步骤，有效降低生产物料与加工成本；相比传统注塑支架生产，更利于批量、标准化制造，提升生产效率与产品一致性	自主研发	产品与刀模设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	磁性辊轴裁切技术	显示用精密功能器件	通过定制一种带有强磁性辊轴，配合厚度仅 0.5mm 柔性复合钢板，在柔性钢板上雕刻出刀锋高度约 0.3mm 刀锋，磁性辊轴上设计专用定位装置，把设计好的柔性钢板按照定位贴合在强磁辊轴上，可临时替代实体圆刀进行器件裁切，该技术应用在结构复杂，精度高产品上，相对于实体圆刀，模具成本节约 60%以上	自主研发	产品与刀模设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	高精度圆角刀锋角度设计与仿真技术	显示用精密功能器件	经 CAD/CAM 协同及逆向工程优化，刀模设计精度重塑，曲面与刃口轮廓更精准，提升加工及模切质量；同时通过五轴联动（CNC）与慢走丝技术，实现 0.2mm 圆角区域达±5um 高精度，满足精密模切对刀模尺寸严苛要求	自主研发	产品与刀模设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	金属模切件边缘平整度技术	显示用精密功能器件	通过逆向工程与参数化建模结合，让圆弧圆角刀模曲面重构误差大幅降低，刃口轮廓更贴合精密模切需求，设计精度从传统模式的“经验依赖型”升级为“数据驱动型”，为后续加工奠定精准基础。弹性缓冲压料机构	自主研发	产品与刀模设计	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术

核心技术	技术名称	应用领域	使用效果、技术先进性及具体表征	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	专利对应情况
			（压面）可自动适应材料厚度与张力，浮动式裁切组件补偿加工与装配公差，两者配合让裁切时材料定位偏差＜0.05mm，毛刺率降至 0.5%以下，挤压变形问题减少 90%以上，实现金属模切件边缘过渡区域平整度，满足消费电子、医疗设备等领域精密模切件的表面质量标准				
精密功能器件精密制造技术	多层次复合材料贴合处理技术	显示用精密功能器件	通过自主研发的贴合设备，完成对多层次复合材料进行预剥离，并同时完成二次贴合，并配套设计张力控制系统及 AOI 检测系统和自动纠偏系统，实现了贴合精度≤0.1mm,贴合过程中横张力控制，提升了材料在裁切前端的稳定性，解决了复合材料由于贴合张力差异性导致的翘曲现象	自主研发	材料复合	应用阶段，应用于主营业务产品	2024107019939 一种模切材料贴合处理方法及贴合装置
	废料剥离角度精密控制技术	显示用精密功能器件	通过自主设计可移动平台，在平台上设计有特殊角度导轨及卡槽，通过卡槽及导轨配合可实现剥离刮刀呈现-45°至 135°范围内进行调整，可结合产品不同结构设置角度达到最优剥离效果，具有操作方便，适配性高，大大降低遗漏风险	自主研发	材料复合	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	零间距智能协控技术	显示用精密功能器件	实现产品间工艺间距的零距离，最大化利用材料，降低人力成本；同时，实现了机械化“零排废”替代人工操作，避免因人工排废导致的产品移位、尺寸不良问题，产品良品率显著提升，生产稳定性增强；此外，通过自动化排废工艺减少人工干预与调试时间，提升生产效率，缩短生产周期，适配大批量连续生产需求	自主研发	模切制作	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	多层材料异步协同技术	显示用精密功能器件	通过异步裁切技术优化主材排版间距，材料利用率显著提升，单位产出量显著提升，减少换卷停机损耗；解决厚主材胶体回粘问题，良品率大幅提升，避免因废料粘连（回粘）导致的产品撕裂、尺寸不良等问题	自主研发	模切制作	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
	Y 向上异步协同送料技术	显示用精密功能器件	通过与线体 X 向出料垂直方向的上异步送料技术，优化主材分布集中性，材料利用率显著提升，单位产出量大幅提升；较于普通型异步技术，解决的同向长间距产品异步无法送料问题，解决了 X 向长尺寸局部材料的异步送料褶皱、气泡等问题；Y 向可以使用宽幅较大，异步位置为 X 向排布的产品类型；同时该技术也解决了 X 同向异步的易产生的问题点，改善了 X 向出料窄宽幅分切痛点，通过更换走料方向提升设备可操作性，解决了分切、模切中的窄料问题瓶颈	自主研发	模切制作	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术

核心技术	技术名称	应用领域	使用效果、技术先进性及具体表征	技术来源	应用的工艺环节	所处阶段	专利对应情况
	全自动折叠对贴技术	显示用精密功能器件	该方案省去人工贴合步骤，以及单片冲压的低效率问题，实现了半成品不停机联机贴合冲压。通过结构贴合改良，解决了两种或多种材料重叠无法裁切的问题，利用贴合设备机构自动翻折对贴后滚轮复压，进而完成贴合，再次套位联机冲切外形的步骤；相比传统多层重叠材料通过单片手工贴合后，单片再次冲压，完成直接跳过人工贴合过程和单片冲压低效率，贴合设备可自动完成折叠对贴，以卷材的形态进入下一道冲切步骤，制作重叠材料产品效率提升	自主研发	模切制作	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术
精密功能器件检测技术	AOI在线检测技术	显示用精密功能器件	通过自主设计检测软件，建立产品资料库，配合红外感应系统以及在线打码技术，可实现对高精度产品尺寸、外观监控，并且可在线进行打码标识，大大降低人员漏失，提升产品质量稳定性	自主研发	AOI 检测	应用阶段，应用于主营业务产品	非专利技术

（五）公司在研项目情况

截至本上市保荐书签署日，公司主要的在研项目情况如下：

序号	项目名称	项目阶段	拟达到的目标水平	应用领域
1	移动设备OLED显示控制板	研发阶段	1.低功耗设计与电源管理：通过增加感光芯片，控制根据环境光强度和显示内容，动态调节屏幕亮度和刷新率。增加局部调光技术，将显示区域划分为多个独立控制区块，对暗区像素降低驱动电流，进一步提升能效 2、电磁兼容性设计：通过将数字电路、模拟电路物理隔离，并采用 PCB 分割接地层技术，避免不同信号间的相互干扰。针对高速信号传输，实施精确的阻抗控制	显示用智能控制卡
2	中小尺寸LCD显示控制板	研发阶段	1、触控控制：通过集成高性能触摸屏控制 IC 芯片，支持自电容和互电容检测，实现 10 点触控和 3mm 悬停识别。针对工业环境，增加了抗干扰设计，确保在电机、变频器等强干扰环境下仍能稳定工作。开发智能手势识别和手掌抑制算法，准确区分有意触控和无意接触，避免误操作 2、可靠性提升：通过优化元器件布局，缩短关键信号路径、分散发热元件并加强散热。通过 PCBA 板表面涂覆三防漆、外露接口配备 TVS 管和稳压二极管、BGA 封装元件 UF 胶加固，提升元件保护能力	显示用智能控制卡
3	LCD显示精密结构件研究	研发阶段	1、石墨烯铜箔包边抗碎裂：采用 PET 外扩屏蔽强化工艺，在石墨烯贴合阶段预覆外扩 0.05mmPET，通过压合使铜箔边缘和 PET 将石墨烯包裹，形成机械防护层，实现裁切面毛刺屏蔽 2、无基材导热胶深冷控流：解决无基材导热胶常温流淌引发的溢胶问题，开发低温贴合-裁切定型工艺：利用-30℃深冷冻结+0.5MPa 贴合把无基材导热胶溢胶宽度控制在＜0.05mm、节省 30min/班清理时间 3、多层复合材料裁切：运用复合导电屏蔽材料，验证不同材料裁切的最佳模具角度，过程中转移保护膜的顺畅剥离，边缘毛刺处理等，达到快速散热，高导通，屏蔽效能好的要求	显示用精密功能器件
4	消费品显示背光模切研究	研发阶段	1、集成化加工系统：采用复合冲裁模实现喷码/裁切/传送工序同步完成，工艺参数：将运行速度≤30 次/分钟，模具间隙<1mm，材料利用率预计提升 30%；配备高精度伺服电机同步传送系统（时序误差±0.1s） 2、防错机制：集成激光喷码模组，采用高精度数字化循环控制系统 3、自动化工艺流程：实现自动化的材料上料、精确定位、喷码质量校验、自动裁切、成品传送等	显示用精密功能器件
5	OLED柔性显示模切研究	研发阶段	1、组合技术：实现多种功能材料的高精度、洁净化组合。解决复合过程中的兼容性问题，确保整个制程环境洁净度达标，特别针对局部微小结构实现无损、完整的精密贴合，避免材料在复合过程中产生压痕、褶皱或污染，同时整合多种工艺设备于一体化的生产流程。实现开发各工艺间的无缝衔接与精准协同控制，实现加工精度的显著提升 2、模具设计：针对特定产品结构，创新性地采用反向设计思维进行模具排版。深度分析材料特性（如延展性、应力分布）与产品几何形状，设计出最大化利用材料幅宽的排刀方案，确保模具结构能精确实现设计意图，预计达成材料利用率从 40%至 90%以上的跨越式提升 3、自动化智能贴装：开发高精度、高柔性的自动化贴装系统，集成视觉定位、精密运动控制、压力传感等关键技术。解决微小、异形或多层部件的精准拾取、对位和可靠贴合问题，实现高效、稳定的自动化生产，提升产品良率与产能	显示用精密功能器件

序号	项目名称	项目阶段	拟达到的目标水平	应用领域
6	大尺寸LCD显示控制板	研发阶段	1、高分辨率与刷新率支持：实现控制板稳定支持4K分辨率、120Hz 高刷新率，以满足消费者对于高清、流畅画面的需求 2、接口兼容性与高速数据传输：实现控制板支持每通道6Gbps以上的数据速率，满足大尺寸LCD常采用V-by-One或eDP接口。确保控制板在高速信号传输中的稳定性与抗干扰能力，优化PCB布局与电源设计，降低信号衰减与延迟。同时支持 HDR10+、局部调光等先进显示技术，提升画面动态范围与对比度表现，为用户提供更优质的视觉体验 3、精准背光控制：对于MiniLED背光的大尺寸LCD，控制板需要具备多区精确的分区控光能力	显示用智能控制卡
7	新能源汽车及储能控制单元	研发阶段	1、高效能量管理模块，设计多通道能量分配电路，实现对电池组的高效充放电管理，支持动态负载均衡，延长电池寿命 2、智能热管理系统，集成温度传感器和散热控制算法，实时监测电池温度，自动调节散热策略，防止过热或过冷 3、高速数据通信接口，采用CAN总线与车载网络无缝连接，支持高带宽数据传输，确保控制板与整车系统的高效协同 4、故障诊断与保护机制：内置自诊断功能，可实时检测电池状态、电路异常等，并触发保护措施，确保系统安全运行	其他
8	可穿戴设备控制板	研发阶段	1.微型化与高密度集成技术：采用刚柔结合板设计，在设备需要弯曲或折叠的部分使用柔性电路与主板刚性部分无缝连接，节省空间并提高可靠性；在组件集成方面采用SiP封装和CSP封装等先进器件封装技术，将主处理器、存储器、电源管理芯片等核心元件以三维堆叠方式集成，大幅减少占板面积 2.热管理与可靠性设计技术：在关键热源位置部署温度传感器件，实现动态温控调节，当检测到局部温度过高时，自动降低相关模块的性能或关闭非必要功能，确保表面温度始终低于40℃的人体舒适阈值	显示用智能控制卡
9	高端笔记本电脑精密结构件模切产品研究项目	研发阶段	1、微米级复合模切工艺：融合激光模切与伺服驱动圆刀模切技术，开发“平刀预切+圆刀精修”复合工艺，实现模切尺寸公差稳定性及高精度，满足先进显示技术要求 2、智能边缘质量优化：采用定制钨钢刀模并增设防粘涂层，配合压力闭环控制系统，解决模切胶带边缘溢胶、卷边问题，搭载AI视觉检测系统，实现边缘缺陷实时识别与工艺参数动态调整，控制边缘平整度误差 3、全尺寸CPK精准管控：通过整合CCD视觉定位等技术构建全流程尺寸监测体系，实现模切产品全尺寸参数实时采集分析，满足自动化机贴对尺寸一致性的严格要求	显示用精密功能器件

三、主要经营和财务数据及财务指标

报告期内，公司经审计的主要财务数据和财务指标如下：

项目	2025年度/2025.12.31	2024年度/2024.12.31	2023年度/2023.12.31
资产总额（万元）	151,342.95	148,913.58	126,002.57
归属于母公司所有者权益（万元）	115,458.72	101,590.09	89,208.40
资产负债率（合并）（%）	23.71	31.78	29.20

项目	2025 年度/2025.12.31	2024 年度/2024.12.31	2023 年度/2023.12.31
资产负债率（母公司）（%）	31.71	33.11	27.07
营业收入（万元）	113,715.36	109,535.20	69,760.95
净利润（万元）	13,325.36	12,059.78	7,572.08
归属于母公司所有者的净利润（万元）	13,329.07	12,059.78	7,572.08
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	12,927.80	11,584.29	6,401.12
基本每股收益（元）	0.34	0.31	0.20
稀释每股收益（元）	0.34	0.31	0.20
加权平均净资产收益率（%）	12.28	12.64	8.89
经营活动产生的现金流量净额（万元）	25,378.94	8,724.06	14,873.65
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	3.29	3.19	4.29

四、发行人存在的主要风险

（一）与发行人相关的风险

1、半导体面板行业周期性波动导致公司未来业绩增速放缓或经营业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为 69,760.95 万元、109,535.20 万元和 113,715.36 万元，较前一年变动比率分别为-6.81%、57.02%和 3.82%，营业收入存在一定的波动。报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 7,572.08 万元、12,059.78 万元和 13,329.07 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 6,401.12 万元、11,584.29 万元和 12,927.80 万元，较前一年变动比率分别为 22.89%、80.97%和 11.60%，公司经营业绩亦存在一定的波动。

半导体显示面板行业属于资本密集型产业，具有投资规模大、建设周期长、产能调整滞后等特征，行业整体呈现明显的周期性波动。该等周期性波动主要表现为面板价格的周期性涨跌、产能利用率的周期性变化及下游库存周期的交替运行。从历史周期看，面板行业经历了多轮显著的周期性波动。2020 年至 2021 年，受居家需求激增及供应紧张影响，面板价格大幅上涨；2022 年至 2023 年，前一轮显示面板行业景气周期主要受益于“宅经济”驱动下的远程办公、在线教育等需求，在此背景下，消费电子终端设备需求提前释放。2022 年起，消费电子需

求出现阶段性透支；2023 年以来，韩国、日本及中国台湾面板厂商陆续推进面板减产或转型，行业经控产保价后逐步企稳；显示技术进步以及 AI 技术的发展持续拉动下游终端需求。

整体来看，面板行业产能投放具有滞后性，新增产能的集中投产可能在未来需求增长不及预期时加剧供需失衡，引发价格下行。目前，尽管我国半导体行业的话语权增强、面板行业市场集中度提升、厂商动态规划“按需排产”成为新常态，显示面板行业周期性波动逐步减弱，但行业周期性特征依然存在。

若未来出现全球宏观经济衰退或区域性经济波动，进而导致终端消费需求收缩、国际贸易环境及关税政策发生重大不利变化、主要显示面板厂商产能策略调整或盲目扩张产能导致供需失衡、显示面板及相关零部件价格大幅下跌、原材料价格大幅上涨、显示面板行业景气度下降，或公司在市场竞争中未能保持在产品开发、产品交付、产品性能、核心技术、客户资源、供应链管理等优势，可能导致显示面板厂商对公司产品需求减少、公司产品销售收入不及预期、在客户体系中被竞争对手替代、市场份额下滑等不利情况，则公司存在业绩波动、放缓甚至下滑超过 50%的风险。

2、技术和产品创新迭代的风险

（1）新产品开发滞后或无法匹配客户、市场需求的风险

产品和工艺技术升级是企业持续发展的重要支撑。公司所处行业下游为新型半导体显示面板及消费电子行业，终端应用更新换代周期较短，下游客户对关键零部件供应商的产品开发能力、工艺制造水平、量产交付能力、产品一致性等方面的要求不断提高。因此，公司需要根据消费电子行业前沿发展趋势和下游市场需求，不断对产品和技术工艺进行创新和改进，以保持对下游客户的持续、稳定供应。新产品开发完成后，最终可否量产还须经客户端的严格检测及认证。

为了在市场竞争中保持持续的竞争力，公司必须不断进行产品结构、工艺制程、性能表现、生产效率、服务内容等方面的创新和升级，持续加大在技术研发、人才培养等方面的投入，从而保持在市场竞争中的竞争优势。若公司存在对工艺技术、产品和市场的发展趋势不能准确判断，对市场需求动态不能及时掌握，对技术路线和产品定位不能及时调整，或新技术、新产品不能得到客户认可等情况，

公司或将无法持续获得客户订单，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（2）核心技术外泄和核心技术人才流失的风险

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，掌握了以显示用智能控制卡、显示用精密功能器件为核心产品的电子互联、生产制造等相关的专利技术和先进生产工艺，是公司核心竞争力的重要组成部分。如果由于知识产权保护不力、竞争对手采取不正当竞争手段、核心技术人员流失等原因导致公司的核心技术外泄，则会对公司的经营造成不利影响。

公司所处的半导体显示面板行业属于技术密集型行业。技术人才队伍是公司持续保持技术优势、市场竞争力和发展动力的重要保障。公司深耕行业多年，在技术开发与生产经营的过程中已逐步建立了具备理论知识、实践经验的技术人才团队。虽然公司始终高度重视对核心技术及核心技术人才的保护，并形成了较为完善的人才培育计划和激励机制，但随着市场竞争加剧，如果公司未来无法保持或及时补充高水平技术人才，或者公司技术人员特别是核心技术人员出现重大流失，则可能对公司在研项目、技术工艺和产品创新等造成不利影响，同时也可能导致公司核心技术的外泄，从而对公司经营造成不利影响。

3、第一大客户京东方销售占比较高的风险

根据《监管规则适用指引——发行类第 5 号》之“5-17 客户集中”，“发行人来自单一客户主营业务收入或毛利贡献占比超过 50%的，一般认为发行人对该客户存在重大依赖”。报告期内，发行人来自京东方的主营业务收入占比分别为 79.10%、53.61%和 55.22%，**发行人对京东方构成重大依赖**。

目前，公司主要产品以新型半导体显示面板为核心应用领域且主要面对国内市场，而京东方系全球及国内出货量第一的半导体显示面板厂商。在京东方市场占有率较高的情况下，若公司无法维持与京东方的合作关系，同时又无法通过拓展其他客户来弥补京东方销售收入下降带来的影响，公司的经营业绩将受到较大影响。

京东方在选择供应商时会执行严格、复杂、长期的认证过程，需要持续对供应商研发和技术创新能力、量产交付能力、质量控制能力、产能规模等进行全面

的考核和评估，其对显示用器件产品建立了严格的测试和验证程序。若未来公司无法在京东方同类供应商中持续保持优势，无法继续维持与其的合作关系，公司的经营业绩也将受到较大影响。

消费电子产品更新迭代周期较短，京东方等显示面板厂商需要及时推出新产品、新技术或使用新器件以匹配终端品牌厂商以及终端消费者的需求。基于此，在京东方等面板厂商的迭代升级中，会不断开展新技术、新工艺、新器件等测试验证，并对其配套零部件产生持续迭代的客观需求。若公司不能及时跟进京东方的需求，或者短期内市场上出现了新技术、新器件而公司未能及时跟进，则公司与京东方之间的商业合作规模可能面临下降的风险，进而影响公司业绩。

4、主要产品价格下降的风险

半导体显示面板行业普遍存在“年降”情形。报告期内，公司与客户签订的协议中的部分存在相关条款，部分产品的销售价格也因此有所下降，进而导致公司主要产品整体价格存在一定波动；此外，下游消费电子行业需求变化以及自身产品结构变动，亦会对公司主要产品平均销售价格产生一定影响。

报告期内，公司主要产品系 LCD、OLED 等新型半导体显示面板专用智能控制卡及其 PCBA 制造服务，并围绕半导体显示面板产业为核心应用领域配套显示用精密功能器件类产品。报告期内，公司显示用智能控制卡业务平均销售价格为 2.86 元/片、5.08 元/片及 5.56 元/片，其中公司显示用智能控制卡产品平均销售价格为 47.49 元/片、68.63 元/片、50.49 元/片，显示用智能控制卡 PCBA 制造服务平均销售价格为 2.19 元/片、2.10 元/片、2.19 元/片；显示用精密功能器件产品平均销售价格为 0.58 元/片、0.61 元/片及 0.60 元/片，均存在一定波动。

若公司未来无法通过持续推出新产品平抑老产品价格下降的影响，或者未来出现下游半导体显示及终端消费电子行业需求受行业政策等因素影响而导致增长放缓或下降、公司新产品开发和迭代速度大幅放缓、上下游行业供需情况发生重大不利变化、与客户价格条款发生重大不利变化、主要产品竞争加剧等负面情形，公司主要产品价格可能面临下行风险，进而会对公司的未来经营业绩产生不利影响。

5、原材料价格波动的风险

报告期内，直接材料占公司主营业务成本的比重分别为 53.04%、69.34%和71.34%，是公司产品成本中的重要组成部分。公司显示用智能控制卡业务主要原材料包括 IC 芯片、电路板、无源器件，公司显示用精密功能器件产品主要原材料包括导电屏蔽材料、光学膜材料、保护膜材料、胶粘材料等，相关原材料采购价格具有一定波动性。

因此，主要原材料的价格波动对公司主营业务成本和盈利水平具有一定影响。若未来主要原材料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

6、财务风险

（1）毛利率下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 23.01%、21.49%和 23.33%，其中显示用智能控制卡业务分别为 27.43%、19.10%、19.38%，2024 年以来保持稳定，而显示用精密功能器件业务分别为 17.59%、25.39%和 29.31%，呈现持续增长趋势。总体而言，公司主营业务毛利率受行业下游需求变化、产品价格变动、产品结构变动、原材料采购价格波动、生产规模效应等因素影响而出现了一定幅度的波动，进而对公司经营业绩产生了一定影响。

若未来出现下游半导体显示及消费电子行业需求受行业政策等因素影响而导致增长放缓或下降、公司新产品开发和迭代速度大幅放缓、产品价格及原材料采购价格发生重大不利变化、上下游行业供需情况发生重大不利变化、与客户价格条款发生重大不利变化等负面情形，则公司毛利率存在下降的风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

（2）应收款项规模较高的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 29,100.45 万元、43,039.67 万元和 37,591.50 万元，占公司流动资产比例分别为 37.49%、47.81%和 41.16%，随着业务规模的扩大而呈现增长态势。公司目前应收款项回收情况良好，且主要客户均为国内知名的半导体显示面板厂商，其经营情况及商业信用良好。

若公司主要客户的经营情况及财务状况出现恶化，或商业信用发生重大不利变化，则可能导致应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（3）存货减值的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 7,345.71 万元、7,149.16 万元和 7,790.86 万元，占流动资产的比例分别为 9.46%、7.94%和 8.53%。若未来公司主要原材料和产品的价格在短期内大幅下降，或因国家政策、市场供给、技术路线变化等因素的影响造成客户变更或取消订单计划，从而导致公司产品无法正常销售，则可能造成相关存货的可变现净值低于账面价值，从而需要计提减值准备，并对公司的经营业绩产生不利影响。

7、关于与部分主要客户约定价格上限条款的风险

报告期内，发行人与部分客户签订的协议中约定了产品最优惠价格条款。鉴于公司主营产品属于“非标准、定制化”产品，不同客户对于同类型产品的功能、参数、规格型号等要求各不相同，公司因此不存在向不同客户销售相同产品的情形，公司销售予不同客户的产品本质上无法进行直接的价格比较。上述条款对公司现阶段客户开拓和经营业绩未造成重大不利影响。

若未来公司与相关客户签署的最优惠价格条款发生重大不利变化而导致公司主要产品价格出现大幅下降或因违反最优惠价格条款而进行赔偿，或将造成公司客户开拓受限等负面情形，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

8、产品质量风险

公司的下游客户主要系国内半导体显示面板龙头厂商，终端客户主要为消费电子品牌厂商，其均对合格供应商提供的产品有着严格的质量标准。报告期内，公司未发生重大产品质量事故或纠纷，若公司未来在产品质量控制方面出现问题，导致客户要求退货、索赔甚至终止合作，或将给公司带来经济和商业信誉等方面的损失，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

9、社保公积金补缴的风险

报告期内，公司存在部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的情形，公司存

在被追缴的风险。公司实际控制人针对该事项已作出承诺。

10、内控风险

（1）管理风险

报告期内，公司经营规模稳步增长，营业收入分别为 69,760.95 万元、109,535.20 万元及 113,715.36 万元；报告期内，公司资产总额分别为 126,002.57 万元、148,913.58 万元和 151,342.95 万元，整体亦呈稳步增长趋势。

报告期内，公司业务规模和资产规模的不断扩大对公司经营管理、人才建设、资源整合、产品研发、市场开拓以及内部控制等方面均提出了更高的要求。随着业务的持续发展和募投项目的投建实施，公司业务和资产规模预计将进一步扩大。

若公司未能有效执行内部管理制度，管理水平无法匹配公司规模的持续扩张，组织架构和管理制度未能及时有效调整、升级，将可能引发相应的管理风险，可能对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

（2）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为王亚龙、李红燕夫妇。截至本上市保荐书签署日，王亚龙、李红燕夫妇直接持有公司 59.31%股权，并通过宇隆企业管理、共青城瑞麟、共青城君成、共青城晓荷、共青城高展、海南瑞麟肆号控制公司 14.86%股权，二人合计控制公司 74.16%股权。王亚龙目前担任公司的董事长，李红燕担任公司的副董事长。

王亚龙、李红燕夫妇作为公司的实际控制人，控制权较为集中。如果实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的发展战略、生产经营和利润分配决策等进行不当控制，将对公司及公司中小股东的利益产生不利影响。

11、税收优惠及政府补助政策变化的风险

报告期内，公司及部分子公司享受高新技术企业所得税优惠税率，适用 15%企业所得税税率等税收优惠，同时亦收到政府补助。若未来公司或上述子公司不能满足持续享受高新技术企业 15%所得税税率优惠的条件或者其他税收优惠政策，公司的综合税率将上升，进而可能给公司的利润水平带来不利影响。

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 1,572.75 万元、785.71

万元和 658.45 万元，占当期利润总额的比例分别为 18.49%、5.72%和 4.35%。若国家相关补助政策发生变化或由于公司自身原因，致使公司不能持续获得政府补助，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

12、2026 年全年盈利预测无法实现的风险

公司编制了 2026 年度盈利预测报告，并经天健会计师审核，出具了 2026 年度盈利预测审核报告（天健审〔2026〕17399 号）。公司预测 2026 年度营业收入、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别为 132,434.09 万元、14,014.65 万元和 14,126.57 万元，同比增长率分别为 16.46%、5.17%和 5.98%。

虽然公司盈利预测报告的编制遵循了谨慎性原则，但考虑到盈利预测所依据的条件假设，以及国内外经济环境、市场变化等具有不确定性，加之不可抗力因素的影响，公司 2026 年度的实际经营成果可能与盈利预测存在一定差异。特此提请投资者注意：公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者应谨慎使用。

（二）与行业相关的风险

1、宏观经济波动的风险

公司主要产品的终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。公司所处电子制造服务业属于电子信息产业，其景气程度与宏观经济发展状况息息相关。

目前，我国已成为全球半导体显示面板产业乃至整个电子信息制造业的主要生产基地之一，相关产业受全球经济环境变化的影响日趋明显，同时下游消费电子行业需求亦受宏观经济及行业周期的影响产生波动。若未来全球宏观经济出现滞胀甚至衰退，或者下游行业景气程度降低，则可能影响下游客户对公司产品的需求，或将导致公司产品销售价格或销售数量的下滑，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

2、国际贸易摩擦的风险

近年来，我国电子制造业快速发展，目前已成为全球电子信息制造业的重要组成部分，我国主要半导体显示面板厂商、终端品牌厂商也随之积极融入并深刻

影响电子信息产业的全球化竞争格局。

报告期内，公司境外销售均为深加工结转业务，不存在直接出口销售的情形，但公司主要产品最终应用为消费电子领域，终端用户为全球消费者，与全球贸易仍存在较为紧密的联系。因此，公司主要产品的需求在一定程度上也会受到各国关税、进出口等贸易政策等因素的影响。若未来国际政治环境、贸易政策、关税壁垒等发生重大不利变化，或相关国家及地区与我国政治、外交、经济合作关系等发生重大不利变化，可能对公司产品需求、原材料采购等造成不利影响。

3、行业政策变化的风险

公司主要产品的终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。

2023 年以来，我国陆续出台了《关于恢复和扩大消费的措施》《关于促进电子产品消费的若干措施》《关于推动未来产业创新发展的实施意见》《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《提振消费专项行动方案》《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》等鼓励支持政策，促进了消费电子产业发展和半导体显示面板及配套零部件市场需求的增长。

2026 年 3 月，我国发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，纲要指出“推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料”以及“壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平”，以加快推动重点产业提质升级、促进我国实体经济和数字经济深度融合。

若相关政策停止或相关政策的支持力度有所减弱，或将会影响发行人下游行业的景气程度，使得下游客户对公司的产品需求增长放缓甚至下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

4、市场竞争加剧的风险

近年来，我国半导体显示面板及消费电子行业稳步发展，并带动配套产业链得到长足的进步，逐步成为全球重要的电子信息产业生产制造基地。报告期内，随着新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等技术的升级进步，以及国内陆续出台“消

费补贴”、“以旧换新”等鼓励支持政策，半导体显示面板及下游消费电子行业景气度逐步企稳回升，行业整体利润水平得到改善，而消费电子行业的良好发展也可能导致未来的行业竞争日益激烈。

截至目前，公司主要产品显示用智能控制卡已取得一定的市场地位。根据 Frost & Sullivan 数据，2024 年公司在中国显示用智能控制卡主要应用领域（包括笔记本电脑、平板电脑、显示器、电视和车载屏幕）的市场份额约为 14%。截至报告期末，公司主要产品产能利用率均已达到 85%以上，处于较高水平。

面对市场竞争不断加剧的局面，行业将可能呈现规模、技术、资金实力等方面的全方位竞争态势。若公司不能顺应市场与行业快速发展的趋势，并通过研发投入、产品创新等方式巩固或提高市场竞争力，或落后于同行业竞争对手，不能保持产品价格的稳定，或者成本控制不力，可能导致公司面临产品竞争力下降、产能利用率下降、新增产能无法得到消化风险，将会使得公司产品在市场竞争中处于不利地位，进而对公司市场份额、盈利能力造成不利影响。

5、近期存储芯片涨价可能导致公司产品终端需求下降的风险

发行人产品主要应用于显示器、笔记本电脑、电视、平板电脑等消费电子终端领域。消费电子终端产品的核心元器件之一为存储芯片，包括 DRAM、NAND Flash 等。2026 年以来，存储芯片市场价格呈现持续上涨态势。受上游晶圆代工产能紧张、AI 及高带宽存储（HBM）需求快速增长、原厂控产保价策略等因素影响，DRAM 及 NAND Flash 主流产品价格自 2025 年四季度起进入上行通道，至 2026 年上半年涨幅进一步扩大。存储芯片价格的上涨直接推高了电视、手机等终端产品的 BOM 成本，终端品牌厂商面临显著的成本压力。未来若存储芯片市场价格发生大幅波动，将通过供应链传导对终端产品的制造成本及终端消费需求产生影响，进而可能对发行人的经营业绩造成不利影响。

与此同时，存储芯片涨价已逐步向终端零售价格传导，可能抑制消费电子终端需求释放。2026 年以来，部分主流消费电子品牌厂商已普遍上调新品终端售价以应对上游成本上涨。消费电子产品属于价格敏感型商品，终端价格的上涨将在一定程度上削弱消费者的换机及新增购买意愿，尤其在中低端产品及新兴市场领域，需求的价格弹性更为显著。若存储芯片价格持续高位运行或进一步上涨，

终端消费需求可能受到抑制，下游终端产品出货量存在下滑风险。

（三）其他风险

1、募投项目实施后效益未能达到预期的风险

公司本次募集资金拟投向合肥宇隆生产基地项目、重庆宇隆二期项目以及补充流动资金项目。公司已结合客户需求、行业发展、市场环境等方面的因素对募集资金投资项目进行了充分的可行性研究，并对募集资金投资项目的投资建设、经济效益、实施进度等方面进行了谨慎测算。

公司拟通过募集资金投资项目的实施，扩大经营规模、提升技术水平、增厚经营业绩，实现公司的长期发展规划。但募集资金投资项目的成功实施仍需市场环境、研发、运营管理等多方因素协同配合，前述因素的重大变化都可能导致募集资金投资项目不能如期完成或顺利实施，这将有可能导致项目成本增加、投产后无法实现预期收益等不利情况，进而对公司业绩带来不利影响。

2、募投项目新增折旧摊销影响公司经营业绩的风险

本次发行完成后，公司的净资产将会大幅增加。本次募集资金投资项目实施完成后，公司固定资产、无形资产规模将有所增加，项目建成后预计公司将新增折旧摊销费用。由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目尚未产生效益或因市场发生不利变化，而同期新增的折旧摊销等成本大幅增加时，则公司存在短期内因新增资产折旧摊销对经营业绩增长产生不利影响的风险。

3、募投项目新建产能无法得到充分消化的风险

公司本次募投项目合肥宇隆生产基地项目、重庆宇隆二期项目达产后，可年产智能控制卡产品近 15,000 万片、年产精密功能器件 30,360 万片，较目前公司现有产能增加较多。

公司本次募投项目系基于公司生产经营实际业务的需要，且有较为广阔的下游市场空间，凭借公司深耕半导体显示行业多年积累的品牌基础、客户资源、技术储备，主要目的系进一步提升公司市场份额和客户产线的覆盖能力，以把握下游 AI 等新技术革命引领下的行业历史性机遇。若未来宏观经济形势、行业政策、市场环境等方面发生不利变化，或公司未能有效开拓市场，则可能面临新增产能

难以消化或募投项目规模化量产能力受限的风险，从而导致本次募投项目无法实现预计效益，并对公司的生产经营产生不利影响。

4、摊薄即期回报的风险

本次公开发行后，公司的总股本和净资产将会相应增加，但募集资金投资项目产生效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的较短期间内，公司每股收益、每股净资产将会受股本增加而出现下降，公司也存在即期回报被摊薄的风险。

5、发行失败的风险

本次发行的结果将受到市场整体情况、公司经营业绩、公司发展前景及投资者对公司认可程度等多种内外部因素的影响。公司存在因发行认购不足而导致发行失败的风险。

第二节 本次证券发行基本情况

一、本次发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	本次拟公开发行人民币普通股不低于 43,033,616 股，且不超过 129,100,845股。 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形，最终发行数量由公司与保荐人（主承销商）协商共同确定	占发行后总股本比例	公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 10%且不高于 25%
其中：发行新股数量	发行新股数量不低于 43,033,616 股，且不超过 129,100,845 股	占发行后总股本比例	发行新股数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%且不高于 25%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行方式	采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，或采用中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在深交所开立股票交易账户的自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、规章及规范性文件禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象		
承销方式	主承销商余额包销		

二、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐代表人

中信证券指定王珺珑、戴顺作为宇隆科技首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人。

王珺珑，保荐代表人，证券执业编号：S1010721010014，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁，参与的项目包括：新铝时代 IPO 项目、莱特光电 IPO 项目、华塑股份 IPO 项目、永和股份 IPO 项目、永和股份 2023 年向特定对象发行股份项目、永和股份 2022 年可转换公司债券项目、盛屯矿业 2021 年 A 股非公开发行股票项目、恩捷股份 2020 年 A 股非公开发行项目、东易日盛 2016 年非公开发行项目、恒逸石化 2015 年非公开发行项目等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

戴顺，保荐代表人，证券执业编号：S1010720090008，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与了当升科技非公开、锡业股份非公开、华友钴业非公开、晶澳科技非公开、国元证券非公开、中国核电可转债、华友钴业可转债、鹿山新材可转债、晶澳科技可转债、皖能电力重组、华友钴业重组、鹿山新材 IPO、宏柏新材 IPO、永和股份 IPO、慧谷新材 IPO 等项目工作。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定王州杰作为宇隆科技首次公开发行股票并在创业板上市项目的项目协办人，指定王巍霖、刘呈豪、马奕桐、杨翔、华文扬、鄢元波、陈志昊、卢秉辰、马凯、康明超作为宇隆科技首次公开发行股票并在创业板上市项目的项目组成员。

王州杰，证券执业编号：S1010119070415，现任中信证券全球投资银行管理委员会副总裁。参与的项目包括：东箭科技 IPO 项目、信邦智能 IPO 项目、龙泉股份非公开发行项目、雄塑科技非公开发行项目、海格通信非公开发行项目、北大方正破产重整项目、新铝时代重大资产重组项目等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行上市的项目人员联系方式

本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员执业情况联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层

联系电话：010-60837212

三、保荐人与发行人的关联关系

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本保荐人持有发行人关联方莱特光电（688150.SH）股票 355,688 股，重要子公司（包括华夏基金管理有限公司、中信金石投资有限

公司、中信证券投资有限公司等）持有莱特光电股票 3,657,581 股。

除此之外，本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员不存在持有发行人权益及在发行人处任职等情况。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

四、保荐人内部审核程序和内核意见

（一）内核程序

中信证券设内核部，负责本保荐人投资银行类项目的内核工作。本保荐人内部审核具体程序如下：

内核部将按照保荐项目所处阶段以及项目组的预约情况对项目进行现场内核。内核部在受理项目申报材料之后，将指派审核员分别从法律和财务角度对项目申请文件进行初审。同时内核部结合项目情况，有可能聘请外部律师和会计师

等专业人士对项目申请文件进行审核，为本保荐人内核部提供专业意见支持。由内核部审核员召集该项目的签字保荐代表人、项目负责人履行问核程序，询问该项目的尽职调查工作情况，并提醒其未尽到勤勉尽责的法律后果。

内核审议在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存在问题和风险的，提出书面反馈意见，内核会召开前由内核部汇总出具项目内核报告。内核委员会以现场会议方式履行职责，以投票表决方式对内核会议审议事项作出审议。同意对外提交、报送、出具或披露材料和文件的决议应当至少经 2/3 以上的参会内核委员表决通过。内核部对内核意见的答复、落实情况进行审核，确保内核意见在项目材料和文件对外提交、报送、出具或披露前得到落实。

（二）内核意见

2025 年 6 月 5 日，于中信证券大厦 25 层 2505 号会议室召开了宇隆科技项目内核会，内核委员会对该项目申请进行了讨论，经全体参会内核委员投票表决，该项目通过了中信证券内核委员会的审议，同意将宇隆科技本次在境内首次公开发行人民币普通股（A 股）并于深交所创业板上市项目申请文件对外申报。

第三节 保荐人承诺事项

保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信证券作出以下承诺：

一、保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关证券发行上市的相关规定。

二、保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

四、保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

五、保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

六、保荐人保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。

八、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施，自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

九、保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

十、保荐人将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，自愿接受证券交易所的自律监管。

第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见

一、推荐意见

中信证券根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人具备《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件。

发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩高速增长，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在创业板上市予以保荐。

二、发行人本次证券发行履行的决策程序

（一）董事会审议通过

2025 年 5 月 26 日，发行人召开第二届董事会第五次会议决议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等与本次发行上市有关的议案，并提请发行人股东大会批准。

（二）股东大会审议通过

2025 年 6 月 13 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等与本次发行上市有关的议案。

（三）保荐人意见

经核查，本保荐人认为：上述董事会、股东大会的召集和召开程序、召开方式、出席会议人员的资格、表决程序和表决内容符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》及发行人《公司章程》的相关规定，表决结果均合法、有效。发行人本次发行已经依其进行阶段，取得了法律、法规和规范性文件

所要求的发行人内部批准和授权，授权程序合法、内容明确具体，合法有效。

三、发行人符合创业板定位要求

（一）发行人符合创业板定位相关指标要求

公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》第四条第二款的相关指标要求，具体情况如下：

创业板定位相关指标二	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入金额不低于5,000万元	√是 □否 □不适用	2023-2025 年，公司研发费用合计10,219.79万元，高于5,000万元
最近三年营业收入复合增长率不低于25%	□是 □否 √不适用	公司最近一年营业收入为 11.37 亿元，高于 3 亿元，不适用营业收入复合增长率要求

注：根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第四条规定，“最近一年营业收入金额达到3亿元的企业，或者按照《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点的若干意见》等相关规则申报创业板的已在境外上市的红筹企业，不适用相关规定的营业收入复合增长率要求。”

（二）发行人符合创业板行业领域要求

根据《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条的规定：属于上市公司行业分类相关规定中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外：（一）农林牧渔业；（二）采矿业；（三）酒、饮料和精制茶制造业；（四）纺织业；（五）黑色金属冶炼和压延加工业；（六）电力、热力、燃气及水生产和供应业；（七）建筑业；（八）交通运输、仓储和邮政业；（九）住宿和餐饮业；（十）金融业；（十一）房地产业；（十二）居民服务、修理和其他服务业。禁止产能过剩行业、《产业结构调整指导目录》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业务的企业在创业板发行上市。

公司专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司主要产品属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

根据国家统计局颁布的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司主营业务及主要产品属于“1.2 电子核心产业”之“新型电子元器件及设备制造”之

“显示器件制造”；根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所属行业属于国家鼓励类产业中的“二十八、信息产业”之“8.显示屏元器件制造及生产专用设备”及“5.新型电子元器件制造”，符合国家产业政策。

公司产品与信息产业深度融合，符合国家产业政策，不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024 年修订）》第五条规定的原则上不支持其申报在创业板发行上市或禁止类行业规定的行业。

（三）发行人关于符合创业板定位的具体说明

1、公司能够通过创新、创造、创意促进新质生产力发展

（1）半导体显示面板行业系我国现代化电子制造业的重要支柱产业之一，是我国现代化制造业体系和新质生产力的重要体现

半导体显示面板作为人机交互、虚拟现实交互的核心平台，承载着信息呈现与用户操作的关键功能。它不仅是用户与设备之间沟通的桥梁，更是实现数据可视化、指令输入和状态反馈的重要载体。从智能手机、平板电脑到工业控制界面、车载系统，再到智能家居和可穿戴设备，半导体显示面板的应用几乎覆盖所有现代电子设备领域。通过高分辨率、触控技术、柔性显示以及动态交互设计，半导体显示面板能够提供直观、高效且沉浸式的用户体验。同时，随着人工智能、5G、物联网 IOT 等技术的快速发展，半导体显示面板正逐渐集成更多智能感知与交互能力，例如手势识别、语音联动和环境自适应等，进一步拓展了人机交互、虚拟现实交互的深度与广度。因此，半导体显示面板不仅是硬件设备的重要组成部分，更是推动数字化、智能化社会发展的基础性技术平台。

半导体显示产业作为电子信息领域的核心产业，对我国电子信息制造业水平的提升发挥了关键作用，其不仅直接贡献了巨大的产业规模和经济价值，还通过技术突破、产业链协同和创新应用，全面推动了电子信息制造业的高质量发展。新型显示作为我国战略性新兴产业中新一代信息技术六大细分领域之一，始终发挥着不可替代的基础性作用。

我国新型显示行业经过多年跨越式发展已经成为全球产业中重要的成长极，“十四五”期间表现尤其突出，不仅为全球产业作出卓越贡献，而且也为我国经济平稳增长提供了有力支撑。目前，我国半导体显示面板产业已实现全球领先的

产能和市场规模。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业高质量发展指数（2025）》，我国新型半导体显示行业 2024 年产值规模的同比增速达到 12%，在全球市场中的占比超过 49%；2025 年，我国新型半导体显示行业的产值规模继续保持 5%左右的增长速度，在全球市场进一步提升至约 54%的占比。

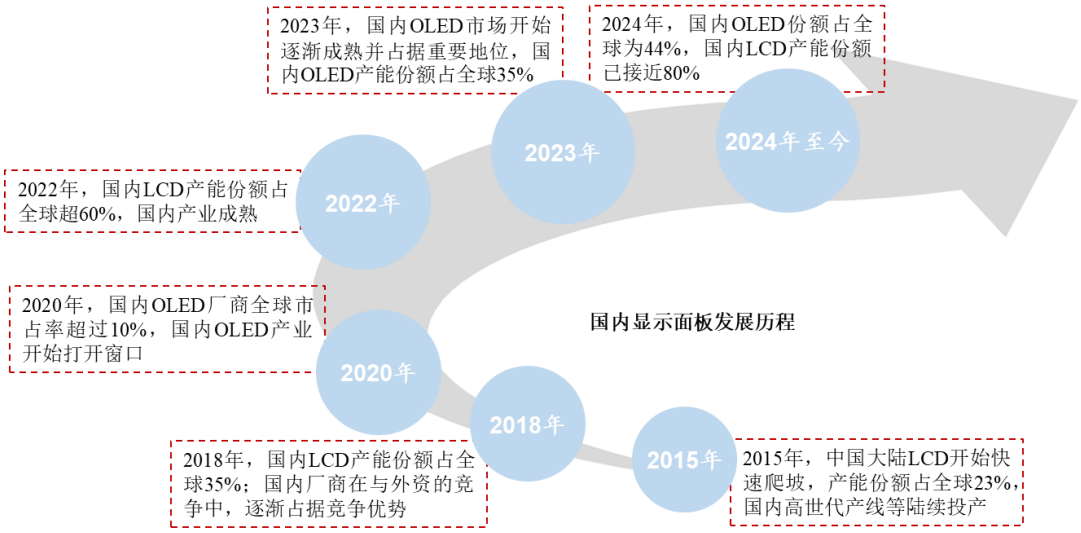
这一规模直接拉动了电子信息制造业的产值增长，并带动了上下游产业链的协同发展，包括装备制造和终端应用等领域。因此，我国半导体显示面板行业能够直接体现国家现代化电子信息制造业和新质生产力的发展水平。

（2）“国产替代”系我国半导体显示面板产业的核心战略发展逻辑

从半导体显示面板产业的发展历史来看，在第一代显像管技术（CRT 技术）时期，中国远远落后西方先进国家并且显示技术的自主程度低，生产线主要依靠进口，彼时显像管合资企业也主要由外国企业主导。

在第二代半导体显示技术（LCD）发展初期，随着 2003 年京东方首条依靠自主技术建设的生产线投建，我国真正逐步建立起来了强大的半导体显示面板产业链体系，并逐步涌现了一批如海思、集创北方等显示驱动芯片优秀企业，使得中国半导体显示面板产业“缺芯少屏”的问题得以解决。中国的 LCD 面板行业在短短二十多年的时间里，全球市场产能份额就从不足 5%增长到目前的 80%左右，成为全球最大的 LCD 面板生产国，中国半导体显示面板产业开始逐步实现国产替代并具备全球竞争力。

经历了 LCD 技术“引进、消化、吸收、自主创新”的过程后，在国产面板龙头厂商的引领下，包括公司在内的核心零部件厂商不断提升技术水平、增强资金实力、扩大产能规模，中国面板行业的世界话语权显著增强。目前，我国在 TFT-LCD、OLED 以及 Mini LED/Micro LED 等新型显示技术领域不再是曾经的“追赶者”，而已经进入行业的“第一梯队”。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业高质量发展指数（2025）》，我国新型显示行业市场竞争力和技术创新能力均得到了显著提升。



回顾历史，半导体显示面板产业曾经一度是中国电子信息制造业的痛点，与发动机技术、芯片技术共同构成中国工业体系曾经“大而不强”的例证。但经历了数十年的发展和沉淀，我国面板产业在国家支持政策、资金、技术、产业链配套等全面支持下飞速发展，在全球半导体显示面板产业占比过半，成为全球第一大面板产业集中地，摆脱了半导体显示面板产业“卡脖子”的历史问题。

目前，全球半导体显示面板主流技术为 TFT-LCD 及 AMOLED 技术。在 TFT-LCD 技术领域，我国已经全面领先，全球市场占比接近 80%；在 AMOLED 技术领域，我国行业不仅取得了规模领先而且还积极探索了具有一定革新性或颠覆性的升级工艺并率先布局了量产项目。更为重要的是，我国半导体显示行业通过规模效应、技术自主化、产业链协同和全球化布局，全面提升了我国整体电子信息制造业的水平。它不仅奠定了中国在全球显示市场的领导地位，更通过创新应用驱动了电子信息制造业的转型升级，为数字经济时代新质生产力提供了核心支撑。

（3）我国半导体显示面板的崛起离不开配套产业链企业的持续投入和技术创新

中国半导体显示面板产业的崛起改变了全球市场格局。通过国家政策引导和企业投入，我国从过去的面板进口国转变为出口国，产业规模的扩大和技术成熟度提升，使中国成为全球电子信息制造供应链中不可或缺的重要一环。除了发展独立自主的关键技术能力，我国半导体显示面板产业的高质量发展离不开完善的产业链配套建设。

公司系我国龙头半导体显示面板厂商重要的合作伙伴，公司主要产品作为半导体显示面板的关键零部件，其性能、精密程度、产品良率和一致性对显示驱动芯片的控制精度和具体功能实现、面板产线生产良率以及终端消费电子产品的智能化、高端化、集成化等均有着直接影响，是我国包括京东方、和辉光电、深天马等厂商 TFT-LCD、AMOLED 等新型半导体显示技术得以实现、投资数千亿的高世代产线顺利投产并稳定运行的关键组成部分，也是我国半导体显示面板产业转型升级并具备与三星、LG 等全球顶级面板厂商同台竞争的重要影响因素。

自 2014 年成立以来，公司深耕新型半导体显示面板的智能控制卡及精密功能器件领域，通过现代化、数字化的生产要素配置以及长期持续的研发投入和技术创新，不断实现自身关键产品、关键生产工艺和核心技术的迭代，推动了半导体显示面板产业的深度转型升级，助力我国半导体显示面板产业链逐步实现“卡脖子”技术的突破，促进我国半导体显示面板产业进一步向“高世代”产线、新型显示技术等方向不断前进。

作为最早进入京东方供应体系的显示用智能控制卡内资制造商，公司于 2014 年打破外资厂商对显示用智能控制卡业务的垄断，并助力半导体显示面板产业链实现高质量、现代化发展，进而带动公司成长为国内领先、国际一流的专注于半导体显示面板智能控制卡及精密功能器件细分领域的一体化解决方案提供商。根据 Frost & Sullivan 数据，2024 年公司在中国显示用智能控制卡主要应用领域（包括笔记本电脑、平板电脑、显示器、电视和车载屏幕）的市场份额约为 14%，市场排名第一，已处于行业领先地位。

整体来看，公司通过创新、创造、创意促进了我国半导体显示面板产业科技成果的高水平应用，推动了我国半导体显示面板行业在全球的发展壮大，助力我国半导体显示面板产业链的升级，有力促进了我国新质生产力的发展，是我国电子信息制造业新质生产力的重要组成部分。未来，随着与人工智能、5G、物联网 IOT 等技术的深度融合，公司也将持续助力并进一步强化我国电子信息制造业的国际竞争力。

2、公司的技术创新性及其表征

自成立以来，公司持续进行研发投入，坚持以研发驱动发展，从而保持对核

心客户、核心技术以及行业趋势的把握和战略布局；同时，公司通过核心技术的应用与迭代不断拓宽产品边界和场景领域，保持持续的经营能力和核心竞争力。报告期内，公司研发费用共计投入约 1.02 亿元。截至报告期末，公司共有专利权 306 项，其中包括 12 项发明专利，另有 46 项发明专利正在申请中，参与了 3 项国家标准的起草制定。

公司被评为国家重点支持专精特新“小巨人”企业、国家智能制造优秀场景、国家级高新技术企业、重庆市“高精度 PCBA 控制板制造数字化车间”、重庆市“高精密 OLED 控制板生产数字化车间”、重庆市知识产权优势企业、中国潜在独角兽企业等，并获得重庆市企业技术中心、重庆市制造业中试平台等资质认定。

截至本上市保荐书签署日，公司及子公司获得的资质及荣誉情况如下：

序号	公司名称	荣誉/资质名称	发证部门
1	宇隆科技	重点支持国家级专精特新“小巨人”企业	财政部、工业和信息化部
2	宇隆科技	国家专精特新“小巨人”企业	工业和信息化部
3	宇隆科技、重庆升越达、合肥宇隆、安徽灿宇、福州宇隆、武汉宇隆	高新技术企业	重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局；安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局；福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局；湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局
4	宇隆科技	国家智能制造优秀场景	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局
5	宇隆科技	重庆市专精特新企业	重庆市经济和信息化委员会
6	重庆升越达、合肥宇隆、安徽灿宇、武汉宇隆	专精特新中小企业	重庆市经济和信息化委员会、安徽省经济和信息化厅
7	安徽灿宇	安徽省专精特新冠军企业	安徽省经济和信息化厅
8	宇隆科技	中国潜在独角兽企业	长城战略研究所
9	宇隆科技	国家绿色工厂	工业和信息化部
10	宇隆科技	重庆市企业技术中心	重庆市经济和信息化委员会、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局、重庆海关
11	宇隆科技	重庆市知识产权优势企业	重庆市知识产权局
12	宇隆科技	重庆市中试平台	重庆市经济和信息化委员会
13	宇隆科技、合肥宇隆	数字化车间	重庆市经济和信息化委员会、安徽省经济和信息化厅

公司深耕新型半导体显示面板的智能控制卡及精密功能器件领域，作为起草单位参与国家标准的起草，主要国家标准的制定体现了公司的行业地位和技术水

平，公司参与起草的国家标准如下表所示：

序号	标准类别	标准名称
1	国家标准	印制板用铜箔测试方法（GB/T 29847-2025）
2	国家标准	柔性显示器件 第6-1部分：机械试验方法 形变试验（GB/T 38001.61-2026）
3	国家标准	电子纸显示器件 第4-2部分：环境试验方法（计划号：20241805-T-339）

公司的技术创新性及其表征主要体现如下：

（1）显示用智能控制卡及精密功能器件均随着半导体显示面板技术变革而不断升级迭代，公司已全面覆盖 LCD 及 OLED 主流新型显示技术路线，并实现了 Mini LED/Micro LED 技术路线的前瞻布局

回顾半导体显示技术的发展历程，自最初的 CRT 技术发展到 LCD 技术的出现，再到如今 OLED 技术已实现广泛的商业化应用，显示用智能控制卡作为半导体显示面板的“大脑”，不仅需要负责面板的信号处理和图像控制，还在确保显示效果和面板性能方面起到至关重要的作用。

随着半导体显示面板的分辨率、刷新率、对比度、色彩表现等指标要求的日益提升，其对显示用智能控制卡及精密功能器件的技术要求同步提升，显示用智能控制卡及精密功能器件的技术难度也在此过程中不断升级演变，具体情况如下：

比较指标	CRT 显示技术	LCD 显示技术	OLED 显示技术
代表性技术	单色 CRT、彩色 CRT	早期：DS-LCD 中期：TN-LCD、STN-LCD 目前：TFT-LCD（包括 a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、Oxide TFT-LCD）	AMOLED（主流）、PMOLED
像素级别	CRT 的分辨率受限于荫罩孔距和荧光点密度，无物理分隔的像素单元，分辨率范围一般在 720P 以下	像素位置精确对应 TFT 阵列，形成规则的网格结构，支持高分辨率，分辨率范围一般在 720P 至 8K	每个像素是独立的有机发光二极管，无需背光；每个像素可单独开关，实现极高的分辨率、无限对比度和真黑色显示；分辨率范围一般在 1080P 以上
响应速度	通常为 1 毫秒	通常为 1-5 毫秒	最快可达 0.01 毫秒
显示控制原理	模拟信号扫描	电压控制液晶分子取向	电流驱动控制像素独立发光
显示控制所需的数据处理量	100Mbps	1.6–48Gbps	25–100Gbps+
显示用智能控制卡 DDIC 和 TCON IC 的数量	不涉及驱动 IC（DDIC）和时序控制 IC（TCON-IC）	通常只有几种优化算法	通常 10 种以上优化算法
显示用智能控制卡元器件规格	1-3 PCS/cm^2	4~7 PCS/cm^2	5~9 PCS/cm^2

比较指标	CRT 显示技术	LCD 显示技术	OLED 显示技术
显示用智能控制卡 PCB 规格	基础 PCB，通常为 4 层板以下	通常 6~8 层 1 阶通孔板 厚度到 0.7mm 左右	通常 8 层以上 HDI 板 厚度到 0.55mm 左右，更窄更薄
显示用智能控制卡作用	通过控制接收视频信号并转换为行/场扫描信号，实现图像传输	通过控制时序生成、数据转换等改变电压实现控制液晶分子取向，相比 CRT 更加复杂	在 LCD 基础上的升级。对每个自发光像素进行精密的“电流”控制，具备实时计算能力，运行复杂的补偿算法来解决 OLED 材料固有的均匀性和寿命问题，相比 LCD 更加复杂
显示用智能控制卡制程	传统的 SMT 贴片，部分器件用手工插件工艺，器件尺寸大部分均为大型器件，精度和焊接要求低，满足 IPC 一级标准即可，对于产品的品质要求较低	新型自动化贴片生产线制造，对于贴片要求较高。高度自动化、标准化、精密化。从锡膏印刷到回流焊，全程由高精度设备完成，追求的是高效率、高良率、高一致性。焊接满足 IPC610 二级标准即可，部分 IC 类器件需要满足 3 级标准。	它在 LCD 的精密基础上，进一步追求极致。对每一个工艺参数的控制都达到顶峰，以确保最终产品电流控制的绝对精确和可靠，同时还增加了点胶制程，对于 BGA 等高度集成 IC 要求底部 100%填充，进一步加强了产品的可靠性，满足了产品的高精度，高品质和高信赖性的需求。焊接要求满足 IPC610 三级标准。
显示用智能控制卡对核心工艺 SMT 的精度要求	元件尺寸：多为 0805 及以上 芯片封装：SOP，QFP（间距≥0.65mm） 贴装精度：±50um	元件尺寸：0402， 0201 为主流 芯片封装：QFP，QFN，BGA（间距 0.5mm-0.8mm） 贴装精度：±40um～±25um	元件尺寸：0201， 01005 大量使用 芯片封装：精细间距 BGA/CSP（间距≤0.4mm） 贴装精度：±30um～±15um
显示用精密功能器件需要实现的功能、数量和精度	功能器件结构单一，规格较大的缓冲、绝缘、导电类的功能器件产品，产品精度偏低,尺寸公差一般±0.5 以内，且应用率较低,材料性能要求不高	需求更高精密的功能器件，偏向多层复合型,产品公差设计要求±0.15 以内偏多；多数固定、遮光、屏蔽、散热等重要功能使用功能器件替代，整套模组需求大量功能器件支撑其性能	高屏占比、高性能等行业要求，定义了此类功能器件整体支撑性能，高散热、导电、屏蔽等性能，多层复合类模切件（SCF、钢片），尺寸公差一般需要达到±0.08 以内，功能器件套件需求量大、一致性要求更高

资料来源：Frost & Sullivan、公开资料整理、中信证券研究

如上表所述，主流显示技术由 CRT 经 LCD 至 OLED 实现三代跃迁，而 LCD 技术更是历经多次技术升级，并持续迭代发展。基于半导体显示面板技术的革新，显示控制单元也从分立式模拟电路发展至集成化数字控制板卡，进而升级到如今的显示用智能控制卡，数据处理量从 100Mbps 升级至 100Gbps，功能亦由单纯的信号调制扩展至像素级电流控制、HDR 元数据处理及动态画质补偿，实现了控制架构的微型化、高速化与智能化迭代。

在显示技术不断迭代的过程中，公司持续把握技术发展趋势，核心产品已全面覆盖 LCD 及 OLED 技术路线。报告期内，公司应用于 OLED 技术产品占比自 2023 年的 18.97%提升至 2025 年的 36.50%，具体情况如下：

单位：万元、%

显示技术终端应用	2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
OLED	40,479.81	36.50	45,953.89	42.92	12,903.95	18.97
LCD	69,055.50	62.27	59,126.99	55.22	52,723.94	77.50
其他	1,365.33	1.23	1,993.31	1.86	2,401.21	3.53
核心产品收入合计	**110,900.63**	**100.00**	**107,074.19**	**100.00**	**68,029.10**	**100.00**

注：核心产品收入包括显示用智能控制卡业务及显示用精密功能器件产品

与此同时，在新型 Mini/Micro LED 领域，公司已进行前瞻性的行业技术布局，目前 Mini LED 和 Micro LED 相关技术领域产品已进入试产阶段。随着 TFT-LCD、AMOLED、Mini LED、Micro LED 等新型显示技术的不断发展，公司能持续紧跟显示技术发展的演变步伐，在新型显示技术领域占据优势地位。

综上，在如今显示技术迭代速度不断加快、新型技术不断涌现的浪潮中，公司凭借持续的研发创新、先进的工艺技术和稳定的产品品质，始终保持与行业领先技术的同步发展，是公司具备技术创新性的重要体现。

（2）公司主要客户系半导体显示面板行业领先厂商，是公司创新能力和技术水平的直接体现

1）半导体显示面板厂商集中度较高，公司已覆盖下游主流客户，该等客户代表了当今全球主流显示技术的先进水平

公司主要产品终端应用于平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域，相关产品的更新周期较短，伴随着新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等新技术的发展与推动，进一步加速了终端消费电子厂商以及半导体显示面板厂商的产品升级与技术迭代。下游客户在终端产品更新换代的过程中，不断开展新技术、新工艺、新器件等测试验证，并对其配套零部件产生持续迭代的客观需求。

因此，公司主要客户京东方、和辉光电、深天马等国内半导体显示面板厂商在产品结构、核心技术、应用领域等方面的先进性可以直接反映发行人的技术和工艺水平，也是发行人核心竞争力以及持续创新能力的具体体现。

截至报告期末，公司主要客户的产能份额情况如下：

主要客户	国内产能份额		显示器件或半导体显示面板领域下游主要客户	公司与其合作关系
	LCD	OLED		
京东方	34.47%	42.95%	苹果、华为、海信、小米、OPPO 等	显示用智能控制卡第一大供应商；显示用精密功能器件前五大供应商
和辉光电	-	11.20%	华为、传音控股、联想、Acer、吉利、小米、蔚来等	显示用智能控制卡第一大供应商
深天马	5.99%	15.97%	联想、OPPO、小米、vivo、索尼等	显示用智能控制卡主要供应商；新建第 8.6 高世代产线显示用智能控制卡第一大供应商
维信诺	-	14.01%	荣耀、小米、OPPO、vivo 等	中尺寸 OLED 显示用智能控制卡第一大供应商
华星光电	27.37%	10.27%	三星、TCL、索尼、华为、小米等	显示用智能控制卡前五大供应商
惠科股份	20.96%	-	三星、LG、小米、海信、TCL、海尔、联想等	显示用智能控制卡前五大供应商
合计	**88.79%**	**94.40%**	-	-

资料来源：长城证券《深天马 A（000050.SZ）：面板领先企业盈利修复，车载＆柔性 OLED 开启成长新周期》，产能份额不包括签约及规划中产能；定期报告、公开资料整理、中信证券研究

注：如无特别说明，维信诺包括维信诺及其参股公司合肥维信诺、广州国显等。

如上表所述，公司主要客户产能已占据国内 LCD 领域 88.79%、国内 OLED 领域 94.40%的份额，该等客户代表了当今全球主流显示技术的先进水平。

作为最早进入京东方供应体系的显示用智能控制卡内资制造商，公司于 2014 年打破外资厂商对显示用智能控制卡业务的垄断，进入半导体显示面板龙头厂商京东方的供应链体系并逐步成为其显示用智能控制卡业务的第一大供应商；此后，公司相继进入和辉光电、华星光电、惠科股份、维信诺、深天马等面板厂商的供应链体系，实现了对半导体显示面板行业主要龙头企业的广泛覆盖。

从终端客户来看，国内主要半导体显示面板覆盖的终端品牌包括了苹果、华为、联想、荣耀、华硕、戴尔、惠普等全球知名厂商，该等终端客户代表了当今全球主流消费电子产品的顶尖水平，亦对搭载的半导体显示面板及其配套显示用智能控制卡、显示用精密功能器件提出了最高的产品标准和技术要求，覆盖了包括平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等各个领域。

2）公司已覆盖国内市场份额超过 80%的主要半导体显示面板厂商，并对该等面板厂商的高世代 LCD 及主流 OLED 产线实现广泛覆盖

在半导体显示面板行业中，“高世代线”是指按照生产线所应用的玻璃基板尺寸划分的大尺寸产线，通常将 LCD 第 8 代以上适宜切割中大尺寸面板的产线称为高世代线。半导体显示面板高世代线的技术突破有效提升了中大尺寸显示面板的生产效率、降低生产成本。因此，高世代线是半导体显示面板行业的重要发展方向，通过技术革新和降本增效，为中大尺寸显示面板的大规模普及和新型显示技术的产业化应用提供了坚实的基础。

OLED 产线（目前主流为第六代及以上）由于革新的产品结构、工艺制程、机器设备等原因，投资金额远高于同代际的 LCD 产线，OLED 显示面板厂商对于上游配套供应商的研发技术水平、制造交付能力、品质可靠性等亦有着极高的要求。

公司的主要产品广泛应用于国内半导体显示面板厂商高世代 LCD 和 OLED 主流产线，亦是公司技术水平和创新能力的直接体现。截至本上市保荐书签署日，公司在下游主要客户高世代 LCD 和主流 OLED 产线的产品覆盖情况如下：

序号	客户名称	高世代 LCD 产线或 主流 OLED 产线数量	公司覆盖数量
1	京东方	12	12
2	和辉光电	1	1
3	深天马	3	2
4	维信诺	2	2
5	惠科股份	4	3
6	华星光电	8	T4 产线已通过认证
合计		**30**	**20**

注：1、LCD 高世代产线指 LCD 第 8 代及以上适宜切割中大尺寸显示面板的产线，OLED 主流产线指 G6 代及以上的产线；2、公司主要为华星光电提供成熟的 LCD 第 6 代产线相关产品，尚未覆盖其高世代产线，其中 T4 高世代产线已通过认证。

综上所述，公司凭借扎实的技术实力、优异的产品性能和稳定的制造交付能力，已实现对国内市场份额超过 80%的主要面板厂商的全面覆盖，同时已完成对该等面板厂商高世代 LCD 及 OLED 主流产线的广泛覆盖。公司已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商、同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商上述业务的主要供应商，相关产品终端应用于国际知名公司的旗舰产品，体现了公司的持续竞争力和技术创新能力。

（3）公司通过持续的研发投入和长期深耕行业的经验积累，逐步搭建完善了智能化的工业算法应用数据库和现代化生产管理体系，是公司技术创新实力和持续经营能力的直接体现

由于消费电子及半导体显示面板行业技术迭代、产品升级周期较短且公司新客户、新业务不断拓展，只有能够快速完成新产品开发（包括设计优化、DFM 可制造性评估、小批量试制等流程）才能够持续获取下游客户订单，进而保持行业竞争力。

公司基于多年来的产品研发、试产及制造经验，自主搭建并不断完善基于 DFM Expert 软件的工业算法应用数据库，即基于公司多年来设计开发的实践积累，导入 3D 设计规则和 3D 器件模型等测试程序和电子元器件数据，至今已累计构建了 20 余万个 3D 器件模型和 1,500 余条设计规则。公司通过模拟仿真软件技术对新产品的设计、可制造性进行模拟评估，识别、优化和输出新产品的最优设计方案，大幅缩短了新产品从前端设计到量产交付期间的开发周期，彻底改变了传统实物试产模式带来的高成本、长耗时、低效率等问题。

与此同时，公司高度重视智能化制造在生产经营中的落实应用。截至报告期末，公司已搭建 MES（生产制造执行系统）、WMS（仓储管理系统）等现代化生产制造管理系统，实现产品制造信息高度自动化及制造过程的全程可追溯性，并通过 ERP 企业资源计划等实现信息化系统管理，实现采购、生产、销售等关键过程一体化，形成了现代化的智能智造生产运营管理体系。

综上，公司凭借现代化工业算法应用和智能智造运营的技术和经验积累，逐步形成了智能化的工业算法应用数据库和现代化的生产管理体系，构建了自身智能设计、快速开发的能力，提升了产品开发和生产管理效率，大幅缩短新产品的开发周期、降低生产制造成本，助力下游客户大幅缩短面板产品的开发周期和迭代速度，从而快速响应终端消费电子的市场变化，实现了现代化先进信息技术与传统制造业的深度融合，是公司技术创新实力和持续经营能力的直接体现。

3、公司属于现代产业体系及其表征

电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，不仅是新质生产力发展的核心引擎，更通过数字化与绿色化转型推动经济发展质效双升，对维

护工业稳定、实现制造强国目标具有不可替代的战略意义。电子信息制造业作为我国工业经济的重要支柱，在稳定经济增长、保障产业链供应链安全、维护国家政治经济安全等方面发挥着关键作用。该行业不仅整体收入规模连续多年位居工业门类首位，更是推动技术创新和产业升级的核心力量。

作为电子信息制造业中新质生产力相关行业的典型代表，新型显示产业的快速发展对保障国家信息安全、提升产业链自主可控能力至关重要，是我国电子信息制造业实现从“最大”到“最强”跨越的重要先锋行业。在关键显示技术领域，我国不仅主导了全球 LCD 产业的升级、迭代，还加速布局 OLED、Mini LED、Micro LED 等前沿技术。目前，中国新型显示产业已形成全球最大的产业集群，根据中国电子信息产业发展研究院发布的《中国新型显示产业高质量发展指数（2025）》，我国新型半导体显示行业 2024 年产值规模的同比增速达到 12%，在全球市场中的占比超过 49%；2025 年，我国新型半导体显示行业的产值规模继续保持 5%左右的增长速度，在全球市场进一步提升至约 54%的占比。

凭借行业领先的技术创新能力，通过现代化生产要素的配置以及长期的研发投入，公司能够共同参与到下游半导体显示面板厂商的关键零部件开发中，不仅可以快速响应下游客户的需求，亦形成了自主创新和产品迭代能力。截至报告期末，公司已广泛覆盖目前主流半导体显示面板厂商的高世代 LCD 产线和主流 OLED 产线，终端产品直接应用于全球知名终端品牌厂商的消费电子产品，体现了公司的现代化技术水平和创新能力。

报告期内，公司核心技术产品带来的营业收入主要为显示用智能控制卡业务和显示用精密功能器件产品，其占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
核心技术产品收入	110,900.63	107,074.19	68,029.10
营业收入	113,715.36	109,535.20	69,760.95
占比	**97.52%**	**97.75%**	**97.52%**

由上表可知，报告期内发行人营业收入主要来自于核心技术产品的销售收入，由核心技术相关产品实现的营业收入比例较高，发行人核心技术已实现产业化。截至本上市保荐书签署日，公司已为京东方、和辉光电、深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等国内主流半导体显示面板厂商供应超过千款显示用智能控制

卡产品，覆盖了 TFT-LCD、AMOLED 等主流显示技术类型。公司现已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商上述业务的主要供应商。

综上所述，公司主营业务、主要产品、核心技术均聚焦于我国现代化产业体系中的新型半导体显示面板领域，并具备进一步研发、深度利用相关技术及模式的能力，公司上述能力具备可持续性。

4、公司的成长性及其表征

（1）电子信息制造业是我国稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的关键领域，我国已出台相关政策促进行业整体稳定、健康发展

根据工业和信息化部、市场监督管理总局于 2025 年 8 月发布的《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，“电子信息制造业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是稳定工业经济增长、维护国家政治经济安全的关键领域。”该方案旨在通过扩大内需、激发市场潜力、促进传统消费升级，培育壮大包括新型显示在内的多个新兴增长点。

该方案着重要求“强化技术和产品形态创新，提振手机、电脑、电视等传统电子产品消费”，并明确提出主要预期目标为“规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在 7%左右，……，到 2026 年，预期实现营收规模和出口比例在 41 个工业大类中保持首位，5 个省份的电子信息制造业营收过万亿，服务器产业规模超过 4,000 亿元，75 英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率超过 40%，个人计算机、手机向智能化、高端化迈进”。

根据我国 2026 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，纲要指出“推进电子信息、机械装备等全产业链创新，发展高端、短缺产品，加快突破关键零部件、元器件和专用材料”以及“壮大数字经济核心产业，发展新一代通信技术、云计算、区块链等产业，提升高端芯片、光电子器件、基础软件和工业软件等产业水平”，以加快推动重点产业提质升级、促进我国实体经济和数字经济深度融合。

公司始终专注于新型半导体显示面板领域的智能控制卡及精密功能器件相关产品的研发、生产及销售，主要产品的核心应用领域主要为新型半导体显示面

板，终端应用主要为平板电脑、笔记本电脑、显示器、中大尺寸电视、手机、智能穿戴等消费电子领域。公司主营业务、主要产品与我国发展电子信息制造业的战略布局高度契合，也将受益于我国电子信息制造业的快速发展，与下游半导体显示面板、消费电子行业终端产品的更新、升级形成同步创新和相互促进的发展道路。

（2）新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等技术领域的快速发展为半导体显示面板及下游消费电子行业注入新的动能

随着新型显示技术、AI 人工智能、5G 通讯等技术的快速升级进步，全球消费电子产品更新换代速度的加快，消费电子换机换新的市场需求将不断增加，为未来发展注入新的动能。

在新型显示技术领域，LCD 显示面板的市场规模稳定增长，OLED 等新型半导体显示面板的市场规模增量显著。根据群智咨询的统计数据，2024 年全球半导体显示面板产业产值达 1,092 亿美元，预计 2025 年将增长至 1,141 亿美元，增长率达 4.49%，其中 OLED 显示技术的快速发展尤为显著。根据 Frost & Sullivan 的统计，从 2020 年到 2024 年，全球 LCD 显示面板的出货面积整体保持稳定，从 2.5 亿平方米增长至 2.6 亿平方米；全球 OLED 显示面板呈现出快速增长的发展趋势，从 2020 年的 0.1 亿平方米快速增长至 2024 年的 0.2 亿平方米，年复合增长率高达 18.2%。根据 Frost & Sullivan 预测，从 2025 年到 2029 年，全球 LCD 显示面板的出货面积将达到 3.0 亿平方米，实现稳定增长，期间年复合增长率为 2.9%；同期，全球 OLED 显示面板的出货面积将增长至 0.4 亿平方米，保持高速发展态势，期间年复合增长率高达 20.8%。

在 AI 人工智能技术领域，相关技术的普及进一步推动行业变革，并促进形成对半导体显示面板产品的增量需求。根据 Frost & Sullivan 数据，伴随 AI 在端侧大模型能力等方面的系统性升级，预计智能手机出货量 2030 年将达到 1,447.4 百万台，2024 年到 2030 年的年复合增长率为 2.6%。随着生成式 AI 应用场景的不断拓展以及用户认知度的逐步提升，未来这一技术将加速向平板电脑、笔记本电脑等终端普及，Canalys 预测全球 AI PC 市场 2024-2028 年期间的复合年增长率将高达 44%，预计未来两到三年中国 AI PC 市场整体增速为 50%左右。

在 5G 通讯技术领域，5G 网络的规模化部署为高端显示的广泛应用提供坚实支撑。根据中国信通院统计，2024 年我国 5G 手机渗透率已超 86%，全年出货量达 2.72 亿部，直接拉动 OLED 等高端面板的搭载需求。群智咨询数据显示，2025 年，全球 OLED 智能手机面板出货量约 8.9 亿片，同比增长 5.2%。其中柔性 OLED 出货量约 6.9 亿片，同比增长约 9.6%。随着全球手机市场进入存量阶段，5G 通讯技术成为发展的新动能。此外，车载显示、智能座舱、AR/VR 等新兴场景持续扩张，多屏化、多场景、大尺寸化等趋势显著，均对半导体显示面板形成广泛需求。

此外，下一代 6G 通讯技术正处于从愿景研究向关键技术攻关和标准制定过渡的关键时期。2022—2025 年，我国已顺利完成第一阶段 6G 关键技术试验，形成超过 300 项关键技术储备。目前正在启动第二阶段技术方案试验。6G 通讯技术在“十五五”时期将重点开展标准研制与产业研发，预计在 2030 年左右启动商业应用。到 2035 年将实现规模化商用部署，有望培育形成万亿元级的 6G 产业及应用市场。预计未来几年，技术方案试验和系统组网试验将逐步展开。按照当前规划，6G 有望在 2030 年左右实现商用，届时将开启万物智联的新时代，为沉浸式通信、智能工业、数字孪生等应用提供基础支撑，从“需求侧”拉动显示面板向更高性能、更多形态、更低功耗的方向升级。这一过程将加速显示技术的迭代，并促使面板企业提前布局相关产能与技术研发。

整体来看，新型显示、AI 人工智能、5G 通讯等新技术领域的深度融合不仅加速了半导体显示面板向高分辨率、柔性化、智能化的升级，也为包括公司在内的半导体显示面板和消费电子产业链创造了新的增长动能和发展机遇。

（3）我国半导体显示面板龙头企业国际竞争力不断增强，为我国电子信息制造服务业企业打开全球市场

经过多年发展，全球半导体显示行业已经达到千亿美元规模。根据群智咨询统计及预测，2022 年至 2024 年全球半导体显示面板产业产值分别为 1,003 亿美元、959 亿美元和 1,092 亿美元，预计 2025-2027 年将持续保持增长，分别将达到 1,141 亿美元、1,161 亿美元和 1,202 亿美元，市场前景广阔。

根据群智咨询数据，2024 年中国大陆半导体显示面板厂商在全球 LCD 显示

面板市场继续保持领先地位，全球市场份额占比为65%，根据群智咨询数据，到2025年中国LCD半导体显示面板产量将占据全球73%的市场份额，进一步巩固其全球供应中心地位；在 OLED 领域，中国厂商同样取得显著成绩，根据群智咨询数据，2025年中国大陆OLED面板占全球的出货份额比例达到49.3%。

中国企业依托本土半导体显示面板优势实现整体发展，细分领域的核心供应商可借助头部面板客户的全球扩张迎来业绩增长的新空间。作为最早进入京东方供应体系的显示用智能控制卡内资制造商，公司于2014年打破外资厂商对显示用智能控制卡业务的垄断，现已成为京东方及和辉光电显示用智能控制卡的第一大供应商，同时也是深天马、广州国显、惠科股份、华星光电等厂商上述业务的主要供应商。随着公司主要客户于全球市场份额的逐步扩大，我国电子信息制造服务业迈向全球市场也将成为公司业绩持续增长的关键影响因素。

四、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件

（一）发行人符合《证券法》规定的发行条件

保荐人依据《证券法》相关规定，对发行人是否符合《证券法》第十二条规定的发行条件进行了逐项核查，核查意见如下：

1、发行人自整体变更设立为股份有限公司以来已依法建立健全了股东会、董事会、审计委员会（报告期内由监事会履行内部监督职能）、独立董事、董事会秘书等各项公司治理方面的制度，建立健全了管理、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度，董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员能够依法履行职责，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第一款第（一）项的规定。

2、根据天健会计师出具的《审计报告》（天健审〔2026〕5466号），2023年度、2024年度及2025年度，发行人归属于母公司股东的净利润分别为7,572.08万元、12,059.78万元及13,329.07万元，扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润分别为6,401.12万元、11,584.29万元及12,927.80万元，具有持续经营能力，财务状况良好，符合《证券法》第十二条第一款第（二）项的规定。

3、天健会计师依据中国注册会计师审计准则对公司2023年12月31日、2024

年 12 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度、2024 年度及 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕5466 号），符合《证券法》第十二条第一款第（三）项的规定。

4、根据检索裁判文书网、查阅公安机关出具的无犯罪记录证明以及发行人及其控股股东、实际控制人出具的声明，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第（四）项的规定。

5、发行人符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

（二）发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件

本保荐人依据《首次公开发行股票注册管理办法》相关规定，对发行人是否符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，具体核查意见如下：

1、发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份公司，具备健全且良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十条的规定

经核查发行人的发起人协议、公司章程、发行人工商档案、《营业执照》等有关资料，保荐人认为，发行人系根据《公司法》在中国境内设立的股份有限公司，发行人的设立以及其他变更事项已履行了必要批准、验资、工商注册及变更登记等手续，发行人是依法设立且合法存续的股份有限公司。经核查发行人设立登记及历次工商变更的证明文件，发行人于 2014 年 3 月 6 日完成有限责任公司法人主体前身设立，并于 2021 年 1 月 29 日整体变更为股份有限公司。保荐人认为，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份公司。

发行人已依法建立健全了股东会、董事会、审计委员会（报告期内由监事会履行内部监督职能）、独立董事、董事会秘书等各项公司治理方面的制度，建立健全了管理、销售、财务、研发等内部组织机构和相应的内部管理制度，相关机构和人员能够依法履行职责。保荐人认为，发行人已经具备健全且运行良好的组

织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

2、发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告；发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十一条的规定

根据发行人的相关财务管理制度以及天健会计师出具的标准无保留意见的“天健审〔2026〕5466 号”《审计报告》，并核查发行人的原始财务报表，保荐人认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。

根据发行人的财务管理制度和内部控制制度、天健会计师出具的“天健审〔2026〕5555 号”《内部控制审计报告》，并核查发行人的内部控制流程及其运行效果，保荐人认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制审计报告。

3、发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条的规定

经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标、计算机软件著作权等资料，实地核查有关情况，并结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，以及对发行人董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员的访谈等资料。保荐人认为，发行人资产完整，资产、人员、财务、机构、业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

经核查发行人历次股东（大）会、董事会会议文件、发行人工商档案及股东名册、发行人报告期内的主营业务收入构成、主要客户及重大销售合同、核心技术人员的劳动合同以及访谈文件、发行人实际控制人出具的声明和承诺，结合发

行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，实际控制人和受实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近两年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件、企业信用报告、发行人涉及的诉讼仲裁、行业研究、分析报告等资料，结合与发行人管理层的访谈、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

4、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十三条的规定

经核查发行人的《营业执照》、主要业务合同、所在行业管理体制和行业政策，取得的工商、税务、社会保障及住房公积金等方面的主管机构出具的有关证明文件，并进行公开信息查询，保荐人认为，最近三年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

经核查发行人董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员提供的个人简历、无犯罪记录证明及其分别出具的相关承诺，并核查股东（大）会、审计委员会（报告期内由监事会履行内部监督职能）、董事会的运营记录，保荐人认为，公司董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。

（三）发行人发行后股本总额不低于 3,000 万元

本次发行前，发行人总股本为 387,302,537 股，本次拟公开发行股票的数量不低于 43,033,616 股，且不超过 129,100,845 股，占发行后总股本的比例不低于

10%，且不超过 25%。按此测算，本次公开发行后发行人总股本不低于 430,336,153 股，不超过 516,403,382 股。

本次发行后发行人股本总额符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

（四）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上

本次发行前，发行人总股本为 387,302,537 股，本次拟公开发行股票的数量不低于 43,033,616 股，且不超过 129,100,845 股，占发行后总股本的比例不低于 10%，且不超过 25%。按此测算，本次公开发行后发行人总股本不低于 430,336,153 股，不超过 516,403,382 股。

发行人本次拟公开发行股份的比例符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

（五）发行人市值及财务指标符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的标准

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条中所规定的具体上市标准包括："发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项：（一）最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元；（二）预计市值不低于 15 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 4 亿元；（三）预计市值不低于 50 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿元。"

根据天健会计师出具的标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕5466 号），公司 2024 年及 2025 年归属于母公司所有者的净利润分别为 12,059.78 万元、13,329.07 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 11,584.29 万元、12,927.80 万元。因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条第（一）款的上市标准，即"最近两年净利润均为正，累计净利润不低于 1 亿元，且最近一年净利润不低于 6,000 万元"。

（六）发行人符合深圳证券交易所要求的其他上市条件

综上所述，发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

第五节 上市后持续督导工作安排

一、持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度；

二、有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人作出说明并限期纠正；情节严重的，应当向中国证监会、深圳证券交易所报告；

三、按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明；

四、督导发行人有效执行并完善防止大股东及其他关联方违规占用发行人资源的制度；

五、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

六、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

七、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；

八、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

九、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

十、中国证监会规定及保荐协议约定的其他工作。

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆宇隆光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

保荐代表人：

王珺珑　　戴　顺

项目协办人：

王州杰

中信证券股份有限公司

2016 年 8 月 26 日

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆宇隆光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

内核负责人：

邱志千

保荐业务负责人：

孙 毅

中信证券股份有限公司

2026 年 8 月 6 日

此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于重庆宇隆光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

董事长、法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

2026 年 8 月 6 日